

股票代號：3581



博磊科技股份有限公司

Zen Voce Corporation

一一三年度年報

刊印日期：中華民國一一四年五月二十三日

公司網址：www.zenvoce.com

公開資訊觀測站網址：<http://mopsplus.twse.com.tw>

一、公司發言人、代理發言人：

發言人姓名：林素真

職稱：管理處處長

電話：03-5599999

電子郵件信箱：sophie@zenvoce.com

代理發言人姓名：蘇建全

職稱：業務部經理

電話：03-5599999

電子郵件信箱：sophie@zenvoce.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及工廠地址：新竹縣新豐鄉精工路 53 號

電話：03-5599999

三、股票過戶機構：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街 17 號 2 樓

網址：<http://www.fubon.com>

電話：02-23611300

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：巫貴珍、陳依玲會計師

事務所名稱：日正聯合會計師事務所

地址：台北市復興北路 33 號 2 樓

網址：<http://nexia.otc.gs>

電話：02-27510306

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：不適用

六、公司網址：www.zenvoce.com

目 錄

壹、致股東報告書

一、一一三年度營業結果	1
二、一一四年度營業計畫概要.....	2
三、未來公司發展策略.....	2
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.....	2

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料...	3
二、公司治理運作情形.....	14
三、會計師公費資訊.....	45
四、更換會計師資訊.....	45
五、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所屬事務所或其關係企業.....	45
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	46
七、持股比例占前十大股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	46
八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	47

參、募資情形

一、資本及股份.....	48
二、公司債辦理情形.....	54
三、特別股辦理情形.....	54
四、海外存託憑證辦理情形.....	54
五、員工認股權憑證辦理情形.....	54
六、限制員工認股權利新股辦理情形.....	54
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	54
八、資金運用計畫執行情形.....	54

肆、營運概況

一、業務內容.....	55
二、市場及產銷概況.....	70
三、從業員工資料.....	79
四、環保支出資訊.....	80
五、勞資關係.....	80
六、資通安全管理.....	83
七、重要契約.....	84

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理事項

一、財務狀況.....	85
二、財務績效.....	87
三、現金流量分析.....	89
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	89
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫.....	89
六、風險管理及評估.....	91
七、其他重要事項.....	93

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	94
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	94
三、其他必要補充說明事項.....	94

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	94
---------------------------	----

壹、致股東報告書

一、一一三年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司 113 年營收淨額新台幣 1,378,232 仟元，較 112 年營收淨額新台幣 1,460,751 仟元減少 5.65%，113 年稅後淨利為 72,382 仟元，較 112 年稅後淨利為 60,234 仟元增加 20.16%。

(二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目			113 年度	112 年度	增(減)%
財 務 收 支	營業收入淨額		1, 378, 232	1, 460, 751	-5. 65%
	營業毛利		458, 480	434, 620	5. 49%
	營業淨利		57, 537	69, 656	-17. 40%
	稅後淨利		72, 382	60, 234	20. 17%
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		4. 05	3. 40	19. 12%
	股東權益報酬率(%)		7. 13	6. 16	15. 75%
	營業利益占實收資本比率(%)		11. 28	13. 66	-17. 42%
	稅前純益占實收資本比率(%)		20. 86	17. 83	16. 99%
	純益率(%)		5. 25	4. 12	27. 43%
	每股盈餘(元)	追溯前	0. 60	0. 55	9. 09%
		追溯後	0. 60	0. 55	9. 09%

註：以上係 113 及 112 年合併財務報表資料

(三) 預算執行情形：

本公司及子公司民國 113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(四) 研究發展狀況

113 年度研發之具體成果如下：請詳第 63~68 頁。

二、一一四年度營業計畫概要

(一)經營計畫

展望 2025 年 AI 應用的持續發展促使尖端半導體產品的需求成長快速推升整體半導體產值，公司也持續開發適合 AI 芯片封裝與測試的解決方案，另外地緣政治和關稅使得生產更貼近客戶，因此 2025 年進行下列營業活動。

1. 研發適合 AI 尖端半導體產品的測試和封裝產品。
2. 開發 wafer saw 在 class 10 環境應用
3. 開發 jig saw kit 提供客戶更好的整體解決方案
4. 開發高瓦數液冷 burn in 解決方案。
5. 子公司科榮(股)公司深耕廠務設備提供高效產品。
6. 因應關稅和地緣政治將生產基地和服務據點更貼近客戶
7. 因應馬來西亞半導體快速成長強化在馬來西亞的銷售通路佈局

(二)重要產銷政策

因應關稅和地緣政治將生產基地和服務據點更貼近客戶，我們更貼近客戶也有更多的研發/生產/客服能量來就近服務客戶提升公司競爭力，創造與客戶的雙贏結果。希望 2025 年的交期和存貨周轉率可以進一步提升。

(三)預期銷售數量及其依據

本公司及子公司無公開財務預測，故不適用。

三、未來公司發展策略

- (一)加強研發投資，開發新的測試平台治具提高混合訊號產品營收比重、提供完整切割方案以提升客戶滿意度確保競爭力。
- (二)配合子公司科榮股份有限公司在廠務和前段的業務，持續開發廠務和前段市場。
- (三)強化治具和耗材銷售，減緩景氣循環對公司的衝擊。
- (四)增強東南亞銷售通路的佈局。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

科技始終來自於人性，而人類追求更優質更便宜更環保的產品不遺餘力，本公司一向以秉持提供客戶具高附加價值的前瞻性解決方案為職志，將整合客戶需求與自身優勢持續研發，簡化作業流程，追求合理化為顧客、股東和員工創造三贏的結果。

董事長 李篤誠



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事：

1. 董事資料

114 年 5 月 1 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女現 在持有股份		利用他人名義持有股 份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主、 管董事或 監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	李篤誠 (註)	男 60 歲	113.06.11	3 年	88.04.09	4,622,950	9.06%	4,622,950	9.06%	1,523,592	2.99%	6,827,517	13.39%	逢甲大學企管系 旺矽科技股份有限公司總經理	旺矽科技(股)公司董事 晨和投資有限公司董事長 贊鴻實業(股)公司董事長 Zen Voce Manufacturing Pte Ltd董事長 Zen Voce(PG) Sdn Bhd董事長 Solution Integration Pte Ltd董事長 博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 科榮股份有限公司董事長 天虹科技(股)公司獨立董事 印能科技(股)公司董事	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內其他董事或監察人關係			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	林文欽	男 60歲	113.06.11	3年	92.10.01	1,682,003	3.30%	1,682,003	3.30%	514,444	1.01%	784,000	1.54%	台北工專電子科 文應實業股份有限公司 博文投資(股)公司董事長 博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 贊鴻實業(股)公司董事 科榮股份有限公司董事暨總經理	—	—	—	—	
董事	中華民國	陳鴻霖	男 51歲	113.06.11	3年	110.07.01	—	—	—	—	—	—	—	—	美國西雅圖西堤大學財務碩士 遠雄人壽保險事業股份有限公司 獨立董事 浩潤纖維股份有限公司 董事長 松霖投資股份有限公司 董事長 浩潤纖維股份有限公司 董事長 台灣精材(股)公司 獨立董事 潤融投資(股)公司 董事 表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表) 惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表) 信泰(股)公司 董事長特助	遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 浩潤纖維股份有限公司董事長 松霖投資股份有限公司董事長 台灣精材(股)公司獨立董事 潤融投資(股)公司董事 表參道餐飲(股)公司董事(法人代表) 惠比壽餐飲(股)公司董事(法人代表) 信泰(股)公司董事長	—	—	—	—
董事	中華民國	蘇顯騰	男 64歲	113.06.11	3年	103.04.10	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台灣大學法律系 國立中興大學科技法律研究所碩士 國立成功大學法學博士 司法人員乙等特考	資深執業律師 旺矽科技股份有限公司薪酬委員	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內其他主、董、監、察人關係			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
															公設辯護人考試及格、律師高考及格 台灣雲林地方法院公設辯護人 資深執業律師					
獨立董事	中華民國	張光明	男 65歲	113.06.11	3年	110.07.01	—	—	—	—	—	—	—	—	清華大學工業工程系畢 台灣大學商研所畢 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理 唐威科技(股)公司董事長 鈦昇半導體材料有限公司總經理 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長 江蘇鈦昇科技有限公司董事 建緯精密科技(股)公司監察人	鈦昇科技(股)公司董事兼總經理 唐威科技(股)公司董事長 鈦昇半導體材料有限公司總經理 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理 江蘇鈦昇科技有限公司董事 翔緯光電股份有限公司董事(法人代表)	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女現 在持有股份		利用他人名義持有股 份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或以 二親等之 內其他主 管、董事或 監察人 之關係			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立 董事	中 華 民 國	曾繼生	男 62 歲	113.06.11	3 年	113.06.11	—	—	—	—	3,000	0.00%	—	—	上海交通大學 EMBA 碩士 中原大學電機系 聯詠科技專案經理	—	—	—	—	
獨立 董事	中 華 民 國	徐金鈴	女 58 歲	113.06.11	3 年	113.06.11	—	—	—	—	—	—	—	—	商業管理研究所 加拿大 Wilfrid Laurier 大學 菱光科技(股)公司 衍生性商品交易監 督人 中華民國會計師 公會全國聯合會 評價暨鑑識會計 委員會委員 中華民國會計師 公會全國聯合會 稅制稅務委員會 委員	安信聯合會計師事務 所執業會計師 甲尚(股)公司獨立董 事	—	—	—	

(註)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊:本公司董事長兼任總經理，主係為提升公司經營效力與決策執行力，有效連結董事會成員隨時參與公司各項決策並凝聚共識，以利達成董事會交辦決議事項。此外，本公司已於 110 年度股東常會選任三席獨立董事，並成立審計委員會取代監察人制度，促使增加董事會外部監督及制衡力量，並達成過半數董事未兼任員工或經理人，以落實公司治理目標。

2. 董事、監察人屬法人股東代表者，該法人股東之主要股東

表一：法人股東之主要股東（股權比例超過 10%或股權比例占前十名）：不適用

表二：表一法人股東之主要股東屬法人股東代表者（股權比例超過10%或股權比例占前十名）：不適用

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長： 李篤誠		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，為本公司之創立者，具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力，對於公司現處之半導體產業發展情況瞭若指掌。未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	1
董事： 林文欽		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司副董事長，長於營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。		0
董事： 陳鴻霖		浩潤纖維股份有限公司董事長、寶成工業股份有限公司寶成紡織權責主管，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。		1
董事： 蘇顯騰		國立成功大學法學博士，現職為資深執業律師，具有豐富法學知識與經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。		0
獨立董事： 張光明		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，為鈦昇科技(股)公司董事兼總經理，具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	0
獨立董事： 曾繼生		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任聯詠科技專案經理，對於半導體產業領域學有專精，長於營運判斷、產業知識。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	0
獨立董事： 徐金鈴		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，為安信聯合會計師事務所執業會計師，具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場觀、領導能力及決策能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。	0

4. 董事會多元化及獨立性：

本公司「公司治理實務守則」第20條中訂定董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

本公司任一性別董事至少一席，但席次未達三分之一，主因具相關產業背景之女性董事較少，短時間難尋合適人才，擬持續透過獨董人才資料庫與產業多管道人才舉薦等方式遴選，以提升企業決策質量，藉由成員不同的專業經驗及廣泛意見，強化治理及營運綜效。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成									多元專業及產業經驗								
	國籍	性別	兼任 本集團 公司 員工	年齡				獨立董事任期年資			營運 判斷	經營 管理	產業 知識	領導 及決策	財務 會計	法律	資訊 科技	風險 管理
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 以上	3年 以下	3至 9年	9年 以上								
李篤誠	中華民國	男			V			V			V	V	V	V	V		V	V
林文欽	中華民國	男	V		V						V	V	V	V			V	V
陳鴻霖	中華民國	男		V							V	V	V	V	V		V	V
蘇顯騰	中華民國	男				V					V	V	V	V		V	V	V
張光明	中華民國	男				V			V		V	V	V	V	V		V	V
曾繼生	中華民國	男				V					V	V	V	V			V	V
徐金鈴	中華民國	女			V						V	V	V	V	V		V	V

(2) 董事會獨立性：

本公司現任 7 席董事中具員工身分之占比為 28.57%，獨立董事之占比為 42.86%。3 位獨立董事中二位任期年資為 0.5 年，另外一位的任期年資 3 年至 9 年。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性（參閱本年報第 7 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露），各董事經學歷、性別及工作經驗（參閱本年報第 3-6 頁-董事資料）。

5. 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 5 月 1 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	李篤誠(註)	男	112.3.8	4,622,950	9.06%	1,523,592	2.99%	6,827,517	13.39%	逢甲大學企管系 旺矽科技股份有限公司總經理	旺矽科技(股)公司董事 晨和投資有限公司董事長 贊鴻實業(股)公司董事長Zen Voce Manufacturing Pte Ltd董事長 Zen Voce(PG) Sdn Bhd董事長 Solution Integration Pte Ltd董事長 博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 科榮股份有限公司董事長 天虹科技(股)公司獨立董事 印能科技(股)公司董事	—	—	—	—
海外事業處處長	中華民國	陳啟華	男	96.03.01	48,488	0.10%	—	—	—	—	矽智科技股份有限公司 澳洲雪梨科技大學商學院	博磊精密設備(蘇州)有限公司總經理	—	—	—	—
管理處處長	中華民國	林素真	女	96.09.01	25,631	0.05%	—	—	—	—	海洋大學航運管理系 博磊科技股份有限公司	贊鴻實業(股)公司監察人 博磊精密設備(蘇州)有限公司監事 科榮股份有限公司管理處處長	—	—	—	—
稽核主管	中華民國	梁淑菁	女	105.3.25	8,000	0.02%	—	—	—	—	輔仁大學 國際貿易暨金融學系 博磊科技股份有限公司 優力特科技股份有限公司	—	—	—	—	—

(註)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司董事長兼任總經理，主係為提升公司經營效力與決策執行力，有效連結董事會成員隨時參與公司各項決策並擬聚共識，以利達成董事會交辦決議事項。此外，本公司已於110年度股東常會選任三席獨立董事，並成立審計委員會取代監察人制度，促使增加董事會外部監督及制衡力量，並達成過半數董事未兼任員工或經理人，以落實公司治理目標。預計114年底前完成新任總經理之委任，以避免潛在可能之利益衝突及落實公司治理。

6. 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

113年12月31日

(1)董事（含獨立董事）之酬金：

單位：新台幣仟元；%

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例		領 取 自 公 司 以 外 轉 資 業 或 母 公 司 酬 金		
		報酬(A) (註 1)		退職退休 金(B)		董事酬勞(C) (註 2)		業務執行費用 (D)(註 3)				薪資、獎金及特 支費等(E) (註 4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註 5)								
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司			
董事長暨 總經理	李篤誠	0	0	0	0	0	0	1,612	1,612	5.23	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038	0	5.23	6.42	0
副董事長	林文欽	0	0	0	0	150	150	0	0	0.49	0.21	0	2,745	0	0	0	0	0	0	7,089	0	0.49	13.79	0
董事	陳鴻霖	450	450	0	0	190	190	60	60	2.27	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.27	0.97	0
董事	蘇顯騰	450	450	0	0	190	190	60	60	2.27	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.27	0.97	0
獨立董事	鄭耀暉	118	118	0	0	190	190	40	40	1.13	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.13	0.48	0
獨立董事	梁振祐	118	118	0	0	190	190	40	40	1.13	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.13	0.48	0
獨立董事	張光明	450	450	0	0	190	190	40	40	2.21	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.21	0.94	0
獨立董事	曾繼生	333	333	0	0	0	0	20	20	1.14	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.14	0.49	0
獨立董事	徐金鈴	333	333	0	0	0	0	20	20	1.14	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.14	0.49	0
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：獨立董事酬金給付政策係依照本公司章程辦理，本公司之董事（含獨立董事）報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，董事長之報酬以不超過總經理支領所得該項數額之 1.25 倍支領。其餘董事（含獨立董事）及監察人之報酬以不超過本公司員工薪資表最高薪階之標準支給。																								
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																								

註 1：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 3：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註 4：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。

註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者。

(2)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等 [◎]		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理(註1)	李篤誠	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038	0	0.00	4.20	0

註1：李篤誠總經理於112年3月8日就任。

(3)前五位酬金最高主管之酬金

113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等 (C)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等四項總額 占稅後純益之 比例 (%)		領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公 司酬金
		本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司		財務報告內所有公 司		本公 司	財務 報告 內所有公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	李篤誠	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038	0	0.00	4.20	0
海外事業處 處長	陳啟華	1,205	2,622	0	0	189	189	0	0	0	0	4.52	3.88	0
管理處處長	林素真	335	1,808	0	0	172	393	8	0	813	0	1.67	4.16	0

(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113 年 12 月 31 日

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	李篤誠	0	0	0	0
	海外事業處處長	陳啟華	0	0	0	0
	管理處處長	林素真	0	8 仟元	8 仟元	0

(註)係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者，則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

7. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

單位：新台幣仟元；%

職稱	113 年度				112 年度			
	本公司		合併報表內所有公司		本公司		合併報表內所有公司	
	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例
董事	5,244	17.01%	5,244	7.24%	5,629	20.17%	5,629	9.35%
總經理及副總經理	0	0.00%	12,872	17.78%	0	0.00%	11,375	18.88%
合計	5,244	17.01%	18,116	25.03%	5,629	20.17%	17,004	28.23%

- (1)董事(含獨立董事)：本公司之董事(含獨立董事)、監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，董事長之報酬以不超過總經理支領所得該項數額之 1.25 倍支領。其餘董事(含獨立董事)及監察人之報酬以不超過本公司員工薪資表最高薪階之標準支給。
- (2)總經理及副總經理：本公司給付總經理及副總經理之酬金包括薪資及獎金等，係依所擔任之職位及所承擔之責任，參考同業對於同類職位之水準釐訂。
- (3)相關酬金皆依對公司貢獻程度暨參考同業水準等要素訂定之，與經營績效之關聯性呈正相關，並依據法令規定揭露給付金額，未來風險應屬有限。
- (4)本公司已於 100 年 11 月 24 日設置薪資報酬委員會，董事及經理人之酬金皆先經薪資報酬委員會討論決議後再提報董事會決議。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

113 年度董事會開會 5 次(A)董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備註
董事長	李篤誠	4	1	80%	連任(註 1)
副董事長	林文欽	5	0	100%	連任(註 1)
董事	蘇顯騰	5	0	100%	連任(註 1)
董事	陳鴻霖	5	0	100%	連任(註 1)
獨立董事	梁振祐	2	0	100%	舊任(註 2)
獨立董事	鄭耀暉	2	0	100%	舊任(註 2)
獨立董事	張光明	5	0	100%	連任(註 1)
獨立董事	曾繼生	3	0	100%	新任(註 1)
獨立董事	徐金鈴	3	0	100%	新任(註 1)

其他應記載事項：

一. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱第 33 頁『最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議』。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。

二. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：請參閱第 34 頁『最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議』。

三. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。請參閱下列附表一：董事會評鑑執行情形。

四. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

①本公司 113 年 6 月 11 日董事會委任第二屆審計委員會委員。

②本公司 113 年 6 月 11 日董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員，每季至少開會一次，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司風險之管控評估。

③本公司 113 年 11 月 7 日設立永續發展委員會。

④本公司定期召開董事會且全程錄音存證並詳實製作議事錄。

註 1：本公司民國 113 年 6 月 11 日股東常會完成第十屆董事改選。

註 2：獨立董事梁振祐、獨立董事鄭耀暉於民國 113 年 6 月 11 日屆滿卸任。

附表一：董事會、董事成員、審計委員會、薪酬委員會自我評鑑之執行情形：

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
每年執行一次	113 年 1 月 1 日 ~113 年 12 月 31	整體董事會	董事會內部自評	評估範圍： 一、對公司營運之參與程度；

	日			二、提升董事會決策品質； 三、董事會組成與結構； 四、董事之選任及持續進修； 五、內部控制。
每年執行一次	113 年 1 月 1 日 ~113 年 12 月 31 日	個別董事成員	董事會成員內部自評	評估範圍： 一、公司目標與任務之掌握； 二、董事職責認知； 三、對公司營運之參與程度； 四、內部關係經營與溝通； 五、董事之專業及持續進修； 六、內部控制。
每年執行一次	113 年 1 月 1 日 ~113 年 12 月 31 日	功能性委員會 (薪酬委員會)	薪酬委員會 內部自評	評估範圍： 一、對公司營運之參與程度； 二、功能性委員會職責認知； 三、提升功能性委員會決策品質； 四、功能性委員會組成及成員選任； 五、內部控制。
每年執行一次	113 年 1 月 1 日 ~113 年 12 月 31 日	功能性委員會 (審計委員會)	審計委員會 內部自評	評估範圍： 一、對公司營運之參與程度； 二、功能性委員會職責認知； 三、提升功能性委員會決策品質； 四、功能性委員會組成及成員選任； 五、內部控制。

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(二)審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公

司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

1. 財務報表。
2. 稽核及會計政策與程序。
3. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 重大資金貸與、背書或保證。
6. 募集或發行有價證券。
7. 衍生性金融商品及現金投資情形。
8. 法規遵循。
9. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
10. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告。
11. 資訊安全。
12. 公司風險管理。
13. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。
14. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
15. 財務、會計或內部稽核主管之任免。

審閱財務報告

董事會造具本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託日正聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經審計委員會查核，認為尚無不合。

113年1月1日至113年12月31日開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	梁振祐	2	100%	舊任(註2)
獨立董事	鄭耀暉	2	100%	舊任(註2)
獨立董事	張光明	4	100%	連任(註1)
獨立董事	曾繼生	2	100%	新任(註1)
獨立董事	徐金鈴	2	100%	新任(註1)

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

董事會日期	審計委員會日期	議案內容及後續處理	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第九屆第12次 113/03/07	第一屆第11次 113/03/07	1. 112年度營業報告書及財務報表案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 112年度內部控制制度聲明書之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第九屆第13次 113/05/09	第一屆第12次 113/05/09	1. 本公司113年第一季合併財務報表案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 本公司擬解除對子	審計委員會全體	全體出席董事同

		公司贊鴻實業(股)公司背書保證案。	成員同意通過	意通過
第十屆第 2 次 113/08/08	第二屆第 1 次 113/08/08	1. 本公司 113 年第二季合併財務報表案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
第十屆第 3 次 113/11/07	第二屆第 2 次 113/11/07	1. 本公司 113 年第三季合併財務報表案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		2. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		3. 訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		4. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		5. 修訂本公司『內控制度-其他管理控制循環』部分條文案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		6. 本公司 114 年度內部稽核計畫之討論案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		7. 本公司擬資金貸與孫公司博磊蘇州精密設備有限公司案。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過
		8. 本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債。	審計委員會全體成員同意通過	全體出席董事同意通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)本公司定期召開審計委員會並視需要邀請簽證會計師、財務主管、會計主管、內部稽核主管及相關主管列席。

(二)內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

(三)審計委員會每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流。

註 1：本公司民國 113 年 6 月 11 日股東常會完成第十屆董事改選。

註 2：獨立董事梁振祐、獨立董事鄭耀暉於民國 113 年 6 月 11 日屆滿卸任。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	是		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	是		(一) 本公司已制定股東會議事規則，並依規定建立發言人與代理發言人制度，設置專人處理投資人關係與股東相關問題，公司網站亦設有投資人專區之處理窗口聯絡電話與E-mail。	無差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	是		(二) 本公司委由股務代理機構，並定期更新股東名冊，以掌控公司股權最終控制者之名單。	無差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	是		(三) 對關係企業間建立「對子公司監理之管理辦法」、「特定公司、集團企業及關係人交易管理辦法」等控管制度。	無差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	是		(四) 本公司已制定「防止內線交易處理程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	是		(一) 本公司已延攬不同商業背景之專業人士，包括(但不限於)技能、地區、專業經驗、教育背景及其他特質，以強化董事會運作能力。	無差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	是		(二) 本公司已設置薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展委員會，並依法運作。目前暫無設置其他各類功能性委員會之需求。	無差異。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	是		(三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，並已執行113年度董事會整體、個別成員及功能性委員會之績效評估，自評評估結果已於114年3月11日向董事會報告，請詳第14~15頁。	無差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是		(四) 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，再將評估結	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			果提報董事會。最近一次評估經114年3月11日審計委員會決議通過後，並提報114年3月11日董事會決議通過。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	是		本公司之公司治理主管負責公司治理相關事務，業經112年3月8日董事會通過設置，前項公司治理相關事務，至少應包括以下內容： (1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (2)製作董事會及股東會議事錄。 (3)協助董事就任及持續進修。 (4)提供董事執行業務所需之資料。 (5)協助董事遵循法令。 (6)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (7)辦理董事異動相關事宜。 (8)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	是		(一)已建立公司發言人制度，由專人做為溝通之管道(註1)。 (二)本公司依規定於公開資訊觀測站公布公司之重大訊息。 (三)本公司已於公司網站中建立「投資人關係專區」，並設有聯絡電話及E-mail等相關資訊。	無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	是		本公司已委任專業股務代辦機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊	是 是		(一)本公司已架設網站，財務業務及公司治理資訊已列為網站項目。 (二)本公司設有專人蒐集及揭露公司資訊，並設有發言人及代	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		否	理發言人。本公司已增設英文網站。 (三) 本公司依照證券交易法規定：於每會計年度終了後三個月內、每會計年度第一季、第二季及第三季終了後四十五日內，公告並申報財務報告。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	是		(一) 員工權益、僱員關懷：本公司訂有各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度等以維護員工權益並照顧員工，且員工與主管間溝通管道順暢，勞資關係良好。 (二) 投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，並公開其聯絡方式，投資人可隨時反映意見。 (三) 供應商關係：供應商管理是本公司相當重視的工作，本公司與各供應商保持良好互動，以創造雙贏之合作。 (四) 董事及監察人進修之情形：本公司不定期提供董事及監察人需注意之相關法規資訊及相關單位舉辦之專業知識進修課程資訊。 (五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各項內部規章並遵循之，以控制風險。 (六) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好及穩定之合作關係，並設置客戶服務專線，由客戶服務部專責提供客戶服務及處理相關問題。 (七) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司章程規定：『本公司得為董事及監察人於任期內執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。』113年4月已為董事購買責任保險。	無差異。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強				

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)				

註 1. 利害關係人聯絡溝通管道：(與各利害關係人溝通情形董事會報告日期為 114 年 5 月 12 日)

利害關係人	關心議題	溝通管道
員工	勞資關係	聯絡窗口：行政部
	員工職涯發展	電子信箱：hr_zv@zenvoce.com
	人才吸引與留任	電話：03-5599999
	員工福利與薪資	溝通方式：Email、電話、福委會、勞資會議
股東/投資人	誠信經營	電子信箱：sophie@zenvoce.com
	經營績效	電話：03-5599999
	公司治理	股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
	資訊安全	電話：02-23611300
	永續發展	溝通方式：Email、股東會、公開資訊觀測站、公司網頁、法說會
客戶	客戶關係管理	電子信箱：sales_zv@zenvoce.com
	產品服務與品質	電話：03-5599999
	供應鏈管理	溝通方式：Email、公司網頁、業務拜訪
供應商	供應商管理	電子信箱：sophie@zenvoce.com
	品質與價格競爭力	電話：03-5599999
	職場安全	溝通方式：Email、公司網頁、供應商評鑑及訪查
政府/主管機關	法令遵循	電子信箱：sophie@zenvoce.com
	公司治理	電話：03-5599999
	風險管理	溝通方式：Email、公文往返、政府政策/法條、不定期參加主管機關舉辦之宣導會

(四)薪資報酬委員會組成及運作情形：

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

114 年 5 月 1 日

身份別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數
獨立董事 (召集人)	徐金鈴	參閱本年報第 7 頁董事專業資格及獨立 董事獨立性資訊揭露相關內容	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監 察人。	0
獨立董事	張光明	參閱本年報第 7 頁董事專業資格及獨立 董事獨立性資訊揭露相關內容	(3)非本人及其配偶、未成年子女或以 他人名義持有公司已發行股份總 數1%以上或持股前十名之自然人 股東。	0
獨立董事	曾繼生	參閱本年報第 7 頁董事專業資格及獨立 董事獨立性資訊揭露 7 相關內容	(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所 列人員之配偶、二親等以內親屬或 三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總 數5%以上、持股前五名或依公司法 第27 條第1 項或第2 項指派代表 人擔任公司董事或監察人之法人 股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決 權之股份超過半數係由同一人控 制之他公司董事、監察人或受僱 人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相 當職務者互為同一人或配偶之他 公司或機構之董事(理事)、監察人 (監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之 特定公司或機構之董事(理事)、 監察人(監事)、經理人或持股5% 以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計 或最近二年取得報酬之商務、法 務、財務、會計等相關服務之專 業人士、獨資、合夥、公司或機 構之企業主、合夥人、董事(理 事)、監察人(監事)、經理人 及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二 等親以內之親屬關係。	0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期： 113 年 6 月 11 日至 116 年 6 月 10 日，113 年度薪資報酬委員會開會共 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	鄭耀暉	1	0	100%	舊任(註 2)

委員	梁振祐	1	0	100%	舊任(註 2)
委員	曾繼生	2	0	100%	連任(註 1)
委員	張光明	1	0	100%	新任(註 1)
召集人	徐金鈴	1	0	100%	新任(註 1)

董事會 日期	薪資報酬 委員會日期	議案內容及 後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
第九屆第 12 次 113/03/07	第五屆第 5 次 113/03/07	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 112 年度盈餘分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		3. 113 年度本公司處長級以上主管薪資報酬政策與績效評估建議案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第十屆第 2 次 113/08/08	第六屆第 1 次 113/08/08	1. 112 年度董事酬勞分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 112 年度經理人紅利分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 薪資報酬委員會職責：本委員會以善良管理人之注意，忠實履行以下職權，並將所提建議提交董事會討論。

(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

註 1：本公司民國 113 年 6 月 11 日股東常會完成第十屆董事改選。

註 2：獨立董事梁振祐、獨立董事鄭耀暉於民國 113 年 6 月 11 日屆滿卸任。

(五)永續發展委員會運作情形：

1. 依據博磊科技永續發展委員會組織規程，該委員會應由至少三名委員，且至少一名

董事參與。博磊科技永續發展委員會的成員目前由董事長及二位主管組成，對永續發展相關議題提供建言。本委員會每年至少召開一次，並向董事會報告執行情形。

2. 本公司董事會於民國 113 年 11 月 7 日設立永續發展委員會，該委員會委員計 3 人。

3. 委員任期：自民國 113 年 11 月 7 日至民國 116 年 6 月 10 日止。

4. 委員會主要職權包含如下：

(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

(2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

(3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

(4) 督導永續發展相關業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

5. 出席情形資訊：

113 年度無召開會議，114 年度委員會開會共 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際列席次數(B)	實際列席率(%)【B/A】	備註
董事長 (召集人)	李篤誠	委員之專業資格與經驗請參閱本年報董事簡介或公司網站	2	100%	新任
委員	林素真		2	100%	新任
委員	林保江		2	100%	新任

永續發展 委員會日期	董事會報告 日期	議案內容及 報告事項	決議結果及 後續處理
第一屆第 1 次 114/01/03	第十屆第 6 次	1. 永續報告書編制及教育訓練進度報告。	委員會全體成員同意繼續依規劃時程執行
		2. 利害關係人鑑別結果報告。	委員會全體成員同意通過
		3. 利害關係人溝通情形及關注議題報告。	委員會全體成員同意通過
第一屆第 2 次 114/05/02	114/05/12	1. 永續報告書編制進度報告。	委員會全體成員同意繼續依規劃時程執行
		2. 2024 年溫室氣體盤查進度報告。	委員會全體成員同意繼續依規劃時程執行
		3. IFRS 永續揭露準則導入計畫。	委員會全體成員同意依主管機關之時程導入

其他應記載事項：

董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理(應敘明其差異情形及原因)：無。

永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1. 已於 113 年 11 月 7 日成立「永續發展委員會」，由董事長擔任主任委員，協助董事會持續推動永續發展策略與願景，強化公司治理體質、環境保護及善盡社會責任為目的，其職權包括下列事項： (1)制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。 (2)企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。 (3)每年定期向董事會報告委員會執行成果。 2. 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則，進行重要議題相關風險評估，並與內外部利害關係人溝通，再依據評估後之風險，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控的風險管理策略及因應措施，以降低相關風險之影響，並於 114 年 5 月 12 日提報董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃；董事會針對提出的報告內容及檢視策略的進度，適時敦促永續發展委員會進行調整。	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		1. 已依循「GRI 3：重大主題」進行重大主題與衝擊判斷。本次重大性原則與風險管理範疇以母公司為主，揭露113年1月至12月永續發展績效表現，風險評估邊界與資料涵蓋範圍以台灣博磊母公司及科榮子公司所有廠區據	無差異

			點為主，後續將逐步納入至各合併報表子公司。每兩年進行重大主題與衝擊判斷重新評估，並報告董事會。 2. 本公司於113年透過問卷調查方式，永續報告書之重大性原則分析方法，以進行內外部利害關係人溝通調查、並透過內部各永續推動小組會議溝通進行衝擊性分析，據以評估具重大性永續議題，針對所辨識的重大議題設定短中長期績效量測與管理方針，並受董事會與永續發展委員會監督。 3. 依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策(請參閱本年報第30頁(註2))。	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司產品組裝所需零組件，均委外製作，無任何環境污染問題；且本公司已制訂『安全衛生工作守則』，積極進行環境、安全、衛生方面之自主管理，以確保員工工作環境之安全衛生，維護生態平衡。	無重大差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		1. 本公司持續提升能源使用效率，包括無紙化、節電、生活垃圾減量回收等。 2. 公司不使用免洗餐具，減少垃圾袋的使用，鼓勵紙張雙面使用並回收。	無重大差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		將溫室氣體減量議題納入風險管理程序，持續評估氣候變遷對公司的潛在風險與機會，並積極推動節能減碳、減少用水與其他廢棄物管理計畫。	無重大差異。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		1. 本公司主要業務為代理買賣、研發設計組裝測試介面及半導體設備，所需零組件均委外生產，故用水量不高且廢棄物也不多。以下資料範圍係台灣博磊及子公司科榮全廠區據	無重大差異。

		點；112 年總取水量為 9.323 千立方公尺(百萬公升)，總淡水取水量為 8.323 千立方公尺，總排水量為 5.768 千立方公尺，總耗水量為 2.555 千立方公尺；113 年本公司總取水量為 9.091 千立方公尺(百萬公升)，總淡水取水量為 9.091 千立方公尺，總排水量為 6.609 千立方公尺，總耗水量為 2.482 千立方公尺，113 年用水量較 112 年增加 9.2%，主因為水塔開關閥老舊故障漏水所致，已於發現漏水第一時間進行維修處理，並啟動用水量即時監測制度，以避免類似情況再發生。本公司 112 年產生廢棄物總量為 25.979 公噸，有害事業廢棄物 0.185 公噸；25.794 公噸為非有害事業廢棄物，佔 99.3%；113 年產生廢棄物總量為 21.836 公噸，有害事業廢棄物 0.038 公噸；21.798 公噸為非有害事業廢棄物，佔 99.8%。另，對於節能減碳與溫室氣體減量策略說明如下： (1)降低能源使用量、提昇效率：選用節能減碳產品如 LED 照明，檢查關閉不必要的電源等。 (2)落實回收減少廢棄物措施：不使用回收餐具以持續進行減少廢棄物，做好垃圾分類已提高可回收廢棄物資源等。 2. 溫室氣體排放(涵蓋範圍：台灣博磊及子公司科榮全廠區據點)，113 年度內部盤查結果。 單位：公噸 CO2e <table><tr><td></td><td>112 年</td><td>113 年</td></tr><tr><td>範疇一</td><td>40.0941</td><td>35.3482</td></tr></table>		112 年	113 年	範疇一	40.0941	35.3482	
	112 年	113 年							
範疇一	40.0941	35.3482							

			<table><tr><td>範疇二</td><td>552.0535</td><td>530.0420</td></tr><tr><td>總計</td><td>592.1476</td><td>565.3902</td></tr><tr><td>密集度(註)</td><td>0.4858</td><td>0.4661</td></tr></table> 註：密集度=公噸 CO2e/當年度公司百萬元營收	範疇二	552.0535	530.0420	總計	592.1476	565.3902	密集度(註)	0.4858	0.4661	
範疇二	552.0535	530.0420											
總計	592.1476	565.3902											
密集度(註)	0.4858	0.4661											
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		公司依法訂定工作規則，並公開揭示同仁週知，其中規範員工的各項權益，如休假、考勤、退休、職災、性騷擾防治、福利與安全衛生等。 人權管理政策及具體方案摘要如下： 1. 提供安全與健康的工作環境。 2. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡：中午休息1小時，給予同仁充足午休時間。 3. 禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令：落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。	無重大差異。									
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		公司薪酬係參考相關業界訂定，休假則完全依法令辦理。如有獲利，則依照章程提撥並發放員工酬勞。	無重大差異。									
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		1. 本公司已制訂『安全衛生工作守則』，積極進行環境、安全、衛生方面之自主管理，以確保員工工作環境之安全衛生，並每年實施員工健康檢查，確保員工安全健康。 2. 113 年度職災件數 0。 3. 113 年度火災件數 0。	無差異。									
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並鼓勵員工自我提升，針對不同職涯能力，參加職訓課程，藉此提升專業能力，實踐員工職涯發展目標，進而達成企業營運目標。	無差異。									

(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司訂有客訴處理作業程序，建立以客戶為導向之品質系統，以期本公司與客戶達到雙贏。此外，本公司重視客戶意見，設有專屬客服部門，提供聯絡窗口及方式，保障客戶權益。	無差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司要求供應商在環保、職業安全衛生及勞動人權等議題遵循相關規範。	無差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		1. 已依循 GRI、SASB 編制 113 年度永續報告書。 https://www.zenvoice.com/esg_download.php 2. 113 年度永續報告書預計 114 年 8 月 31 日前完成申報。	無差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

113 年度捐贈慈善公益團體情形：

項次	受捐單位	捐款金額
1	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	2,200,000

2	國立嘉義高中	800,000
3	新竹市體育會(富才杯網球賽)	500,000
4	國立嘉義女中	400,000
5	新竹交響管樂團	200,000

註 2：本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策如下：

重大議題面向	風險評估項目	主要管理方針/政策
環境	環境衝擊及管理	1. 依政府法令，階段性完成溫室氣體盤查母公司暨合併報表子公司導入與查證作業。 2. 依據 ISO 14064-1 標準，定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，公司檢討碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。
社會	產品品質安全	1. 優良產品、完善服務、遵守法規而增強客戶競爭力。 2. 依循 ISO 9001 品質管理系統提升整體產品流程品質，提供客戶穩健與高品質產品。
	職業安全衛生	1. 定期檢討並提升職安環境。 2. 每年定期舉行消防演練和不定期工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。
公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
	強化董事職能	1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
	資訊安全	1. 加強資訊安全宣導。 2. 持續更新設備與升級防火牆。

(七)上市上櫃公司氣候相關資訊。

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為本公司氣候變遷管理之最高監督單位，負責審閱年度公司治理報告，並確保氣候相關風險管理制度之有效執行。本公司於113年11月7日成立永續發展委員會，作為公司最高階層的ESG推動組織，負責擬定企業永續策略與長遠願景，旨在強化公司治理體質、落實環境保護，並積極履行社會責任。該委員會由董事長為召集人及兩名主管組成，以企業永續發展為最高指導原則，並依規定每年至少召開一次會議，定期向董事會報告氣候變遷相關之經營成果與推動成效。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	公司積極研擬解決方案，期望能降低氣候變遷帶來的營運與財務衝擊，提升組織氣候韌性。 並定義短期為1~3年，中長期為3年以上（註：公司應依自身營運狀況定義短中長期），評估相關氣候風險與機會為公司帶來的潛在營運與財務影響，以規劃各項行動因應氣候相關風險與機會。 博磊的氣候風險與機會分為短期與中長期，短期為1~3年，中長期為3年以上。博磊辨識出五種風險與五種機會：五種風險包括：(1)溫室氣體相關法規(屬於政策和法規風險)、(2)低碳技術轉型(屬於技術風險)、(3)客戶行為改變(屬於市場風險)、(4)立即性風險、以及(5)長期性風險等五種。五種機會包括：資源使用效率、能源來源、產品和服務、市場以

	及韌性等五種。藉由管理這些風險與機會來降低氣候風險所帶來對業務、策略與財務造成的潛在影響。(註1)
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件對財務之影響，包括有颱風、洪水、地震等，可能導致營運中斷、供應鏈受損及保險成本增加。而轉型行動對財務之影響，為因應氣候變遷，各國政府紛紛祭出碳排放管制措施，促使產業轉型至低碳經濟，及因應碳排管制，可能採取的轉型行動包括發展綠色產品與加入碳中和行列。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	辨識氣候風險的方式包括：檢視氣候變遷趨勢、分析供應鏈風險，與評估極端氣候事件之影響。 評估氣候風險的方式為：分析氣候風險對營收、獲利、資本支出等之財務影響，以及評估氣候風險之發生機率及影響程度，以作為風險管理之優先順序。 管理氣候風險的方式：制定減碳目標及行動計畫，以降低碳排放，因應氣候變遷之挑戰；發展綠色產品，以滿足市場需求，提升競爭力。 本公司將氣候風險管理整合於整體風險管理制度的方式為：將氣候風險納入本公司風險管理架構，並定期進行風險評估及管理，以利利害關係人瞭解本公司因應氣候變遷的作為。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未開始使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。

6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司尚未有因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎	本公司尚未開始使用內部碳定價作為規劃工具。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司尚未設定氣候相關目標、未使用 RECs 或碳抵換機制。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	另填於註 2-(1)及註 2-(2)

註 1. 本公司氣候變遷風險及對應措施，如下表說明：

	風險	氣候變遷風險辨識	潛在營運與財務影響		對氣候變遷風險之管理措施	
轉型風險	政策和法規風險	溫室氣體相關法規	短期影響：	極端氣候可能導致博磊遭受財產損失、營收減少、保險成本增加等。	短期目標：	博磊非屬環保署公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管對象。本公司仍持續了解法規變化趨勢，做好因應準備。
			中長期影響：	因應台灣溫室氣體的規範，公司須提升能源使用效率，且可能受潛在碳稅、碳交易制度，增加營運成本。	中長期目標：	1. 制定節能減碳目標，以降低碳排放，因應氣候變遷之挑戰。 2. 啟動溫室氣體盤查規劃，揭露博磊的溫室氣體排放。
	技術風險	低碳技術轉型	短期影響：	可能需要調整產品或服務策略，以因應氣候變遷的影響。	短期目標：	廣納客戶意見，持續研發符合客戶需求之產品。

			中長期影響：	可能需要轉型至低碳經濟模式，以因應氣候變遷的挑戰。節能減碳產品需求增加，博磊可能需調整營運模式，藉此開發新產品或服務，以拓展市場。	中長期目標：	1. 持續創新產品，以滿足市場需求，提升競爭力。 2. 提供符合市場產品法規與標準之解決方案。
	市場風險	客戶行為改變	短期影響：	極端氣候可能導致營運中斷、供應鏈受損，影響營收及獲利。	短期目標：	廣納客戶意見，持續研發符合客戶需求之產品。
			中長期影響：	氣候變遷可能導致市場結構改變，需要重新定位其市場定位。隨著市場趨勢變化，客戶要求綠色產品認證及其他環保相關要求，若無法符合客戶要求，可能導致商品及服務需求下降。	中長期目標：	1. 調整營運模式以因應氣候變遷的挑戰。 2. 提供符合市場產品法規與標準之解決方案。

	風險	氣候變遷風險辨識	潛在營運與財務影響	對氣候變遷風險之管理措施
實體風險	立即性風險	政府推動節能政策	各國政府紛紛祭出碳排放管制措施，促使產業轉型至低碳經濟。經濟部能源局節能法規要求契約用電容量 801~10,000 瓩者，2015-2024 平均節電至少達 1%。	因應碳排管制，可能採取的轉型行動包括發展綠色產品與加入碳中和行列。博磊契約用電容量 350 瓩，遵循法規政策節能並落實，希冀未來每年節電率達至少 1%，以降低耗電量及碳排放。
		缺水或限電，造成生產供應鏈中段或原物料短缺	若降雨過少或是供電短缺可能會影響供應鏈製程穩定性，造成客訴或營運成本增加。	除了供應鏈全球化佈局外，亦有應變小組，擬定應變及服務等級之計畫，檢討精進並確保災害或衝擊發時，可全維持最高營運目標。
		平均溫度上升，引發營運據點限電斷線的風險	平均溫度上升使機房冷氣用電成本增加，若電力供給中斷，將導致廠務設備無法運轉，使公司營運中斷。	當電力中斷時，機房伺服器乃至全公司配有不斷電系統（UPS）；建置緊急發電裝置供電，可支援辦公用電需求。

	長期性風險	降雨模式改變與天氣變化劇烈，引發營運據點限水的風險	若供水中斷且蓄水量無法支援，導致重要廠務設備無法運轉，進而導致支援研發設計之機房伺服器無法運轉。	廠內既有蓄水量可支援民生用水需求達 3 天以上，自來水供水不足時，啟動水車載水補充自來水池。
		颱風導致暴雨發生的頻率增加	若颱風及水災規模大，影響時間過久，可能會造成廠務設備損壞，影響公司正常營運。	針對廠務設施，確保地下抽水泵浦運作正常，預先做好防護措施。

機會	氣候變遷風險辨識	潛在營運與財務影響	對氣候變遷風險之管理措施
資源使用效率	水資源回收再利用	減少用水量和耗水量	給水裝置全部加裝變頻器以穩定水壓，公共洗手間全面採用感應式水龍頭，購買具備省水標章之產品，有效控制用水量，減少不必要的水資源浪費。
能源來源	政策獎勵	降低營運成本	汰換設備時，配合政府補助政策，申請相關節能補助。
產品和服務	研發與產品創新	開發創新技術及低碳產品，滿足客戶對低碳產品的需求。	研發適合 AI 尖端半導體產品的測試和封裝產品，以滿足客戶需求。
市場	尋求新商機	響應各國政府政策，尋找新商機，以提高營業收入。	因應關稅與地緣政治，將生產基地與據點更貼近客戶，強化馬來西亞銷售通路布局。
韌性	產品多元化	透過確保韌性的新產品和服務來增加收入。	站在客戶需求角度去服務客戶，並積極開發測試、封裝產品。

註 2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：

(1)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

溫室氣體排放涵蓋範圍；母公司及子公司科榮全廠區據點

	範疇一	範疇二	範疇三	總計	密集度(CO2e/當年度公司百萬元營收)
112 年	40.0941	555.0535	-	592.1476	0.4858
113 年	35.3482	530.0420	-	565.3902	0.4661

(2)溫室氣體確信資訊：依「上市櫃公司永續發展路徑圖」目前尚未到規定確信時間。

(八)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

1. 誠信為本公司之核心價值，於會議及員工訓練中宣導並落實。
2. 本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」。
3. 落實誠信經營情形：

評 估 項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且	是		(一)本公司已制訂「誠信經營守則」。 本公司已於「誠信經營守則」中明訂檢舉及懲戒制度，並向全體同仁公告宣達。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	是		(三) 除「誠信經營守則」明訂禁止不誠信行為外，並遵守相關法令及政策。	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是	否	(一) 本公司與往來對象簽訂契約時，充分瞭解對方之誠信經營狀況，但尚未於往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款。 (二) 本公司「誠信經營守則」明訂本公司由管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定與推動，由內部稽核人員負責監督執行，並作成稽核報告提報董事會。公司治理與法令遵循向董事會報告日期 114 年 5 月 12 日。 (三) 本公司「誠信經營守則」明訂迴避相關規範，各項業務並皆設有權責業管窗口。 (四) 本公司設有專責之稽核單位，定期進行內控查核管制，相關作業規範於公開資訊觀測站申報。 (五) 本公司於定期主管會議及部門內部會議宣導誠信經營相關事項。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程	是		本公司已於「誠信經營守則」中明訂檢舉及懲戒制度，並向全體同仁公告宣達。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？				
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		否	依公司治理意旨，公告相關財務及經營資訊，以利利害關係人了解企業營運狀況。另本公司依法於公開資訊觀測站公告相關資訊。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。				

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司新任董事及經理人，於就任時均分發財團法人中華民國櫃檯買賣中心所編製之「上櫃及興櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」，以利內部人遵循。

113 年本公司董事進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	進修日期	課程名稱	進修時數
董事長	李篤誠	台北金融研究發展基金會	113.08.06	從證券交易法看企業及董監事責任義務	3
		社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3

副董事長	林文欽	社團法人中華財經發展協會	113.05.08	2024 下半年全球經濟情勢展望	3
		社團法人台灣專案管理學會	113.11.21	董事會 vs 經營團隊	3
董事	陳鴻霖	財團法人中華經濟研究院	113.04.12	綠色經濟趨勢分析	3
		台北金融研究發展基金會	113.09.09	稅務洗錢風險防範-國家八大洗錢風險態樣	3
董事	蘇顯騰	社團法人中華公司治理協會	113.08.13	企業經營與危機管理	3
		社團法人中華公司治理協會	113.11.26	企業及大股東資產管理全攻略	3
獨立董事	張光明	社團法人台灣專案管理學會	113.06.07	董事會 vs 經營團隊	3
		社團法人台灣專案管理學會	113.06.13	接班團隊建構與人才發展	3
獨立董事	曾繼生	證券櫃檯買賣中心	113.09.11	上櫃興櫃公司內部人股權宣導	3
		社團法人中華公司治理協會	113.11.15	全方位的智財保護策略-以 AI 協助智財合規管理新思維	3
		社團法人台灣專案管理學會	113.11.21	董事會 vs 經營團隊	3
		中華民國公司經營暨永續發展協會	113.11.27	董事會實務爭議之解析	3

獨立董事	徐金鈴	財團法人中華民國證券暨期貨交易 發展基金會	113.04.25	員工獎酬策略與工具運用探討	3
		中華民國會計師公會全國聯合會	113.10.08	會計師執業應注意的洗錢態樣，稅務犯罪案例解析	3

(十)內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書：可詳公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內
控聲明書公告。(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20)

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 113 年股東常會重要決議內容及執行情形：

(1) 112 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112 年度盈餘分配案。

執行情形：訂定 113 年 7 月 17 日為除息基準日，已依股東會決議於 113 年 8 月 8 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 0.5 元。)

2. 董事會之重要決議：

開會日期	重要決議	證交法 §14-3或 §14-5 所列事項	獨立董事 意見及公 司對意見 之處理	董事會之決議結 果
第九屆 第 12 次 113.03.07	通過本公司與台灣中小企業銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司處長級以上主管薪資報酬政策與績效評估建議案。		無	經出席董事同意通過
	通過 112 年度營業報告書及財務報表案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過 112 年度盈餘分配案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過全面改選董事暨提名案		無	經出席董事同意通過
	通過解除新任董事競業禁止限制案		無	經出席董事同意通過
	通過擬訂定召開本公司 113 年股東常會暨受理股東提案期間及處所相關事宜。		無	經出席董事同意通過
第九屆 第 13 次 113.05.09	通過解除本公司對子公司贊鴻實業股份有限公司背書保證案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過本公司與台北富邦銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司與玉山銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過

	通過 113 年第一季合併財務報表案。	V	無	經出席董事同意通過
第十屆 第 1 次 113.06.11	推選董事長及副董事長案。		無	全體董事一致同意推選李篤誠董事擔任董事長，林文欽董事擔任副董事長。
	推選第二屆審計委員會召集人及審計委員會主席。		無	全體董事一致同意推選徐金鈴獨立董事擔任審計委員會召集人及審計委員會主席。
	推選第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。		無	全體董事一致同意推選徐金鈴獨立董事擔任薪資報酬委員會召集人及薪資報酬委員會主席。
第十屆 第 2 次 113.08.08	通過 113 年第二季合併財務報表案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過審議董事酬勞分配案。		無	審議各董事之酬勞時，該董事依公司法規定利益迴避後，經其他出席董事同意通過
	通過審議經理人紅利分配案。		無	經出席董事無異議照案通過
第十屆 第 3 次 113.11.07	通過 113 年第三季合併財務報表案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過「永續發展委員會組織規程」。	V	無	經出席董事同意通過
	通過設置永續發展委員會案。		無	經出席董事同意通過
	通過「永續報告書編製及確信作業程序」。	V	無	經出席董事同意通過
	通過「永續資訊管理辦法」。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「內控制度-其他管理控制循環」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過 114 年度稽核計劃審核案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過本公司擬資金貸與孫公司博磊蘇州精密設備有限公司案。	V	無	經出席董事同意通過

	通過本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過本公司與台新銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司與土地銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司與第一銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司與華南銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司與上海商業銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司與新光銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
第十屆 第 4 次 114.01.15	通過本公司擬增資孫公司博磊蘇州精密設備有限公司案。		無	經出席董事同意通過
	大陸南通使用權(租賃)合約案。	V	無	1. 完善合約條款，並增加部分出租、優先承購權及押金等問題後。 2. 徵詢大陸律師對租賃合約適法性意見，如最高 20 年租賃期限之問題，再重新召開會議討論。
第十屆 第 5 次 114.03.11	通過解除大陸南通使用權(租賃)合約案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過本公司與台灣中小企業銀行之綜合融資契約申請展期案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司擬資金貸與孫公司博磊蘇州精密設備有限公司案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過 113 年度員工酬勞分派案。		無	經出席董事同意通過
	通過 113 年度董事酬勞分派案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司處長級以上主管薪資報酬政策與績效評估建議案。		無	經出席董事同意通過
	通過 113 年度營業報告書及財務報表案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過 113 年度盈餘分配案。		無	經出席董事同意通過
	通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。	V	無	經出席董事同意通過

	通過修訂「內控制度-投資循環」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過本公司基層員工定義案。		無	經出席董事同意通過
	通過修訂「公司章程」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「內控總則」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「誠信經營守則」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「內部重大資訊處理程序」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「防止內線交易處理程序」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過解除董事競業禁止限制案。		無	經出席董事同意通過
	通過 114 年度財務報告簽證會計師委任及報酬案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	V	無	經出席董事同意通過
	通過擬訂定召開本公司 114 年股東常會暨受理股東提案期間及處所相關事宜。		無	經出席董事同意通過
第十屆 第 6 次 114.05.12	通過 114 年第一季合併財務報表案。	V	無	經出席董事同意通過
	本公司於 112 年 3 月 8 日董事會決議通過大陸江蘇省南通市投資案，擬將投資地點變更為江蘇省蘇州市。		無	經出席董事同意通過

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)其他應揭露事項：

113 年度本公司公司治理主管、會計主管及稽核主管進修情形如下：

職稱	姓名	進修機構	進修日期	課程名稱	進修時數
公司治理主管	林素真	社團法人中華公司治理協會	113.01.19	高階經理人薪酬與ESG績效制度設計	3

		財團法人中華民國會計研究發展基金會	113.01.29~ 113.01.30	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
		財團法人中華民國會計研究發展基金會	113.02.27	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3
會計主管	林素真	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113.12.12~ 113.12.13	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	梁淑菁	內部稽核協會	113.10.08	查核技巧實務	6
		內部稽核協會	113.11.11	自行評估實務	6

三、簽證會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
日正聯合會計師事務所	巫貴珍	113/1/1~113/12/31	1,800 仟元	0 仟元	1,800 仟元	無
	陳依玲					

公司有下列情事者，應揭露會計師公費：

- (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情形。
- (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費更換前後金額、比例及原因：無此情形。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

四、更換會計師資訊：無。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度 截至 5 月 12 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數

職稱	姓 名	113 年度		114 年度 截至 5 月 12 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事	李篤誠	0	0	0	0
董事	林文欽	0	0	0	0
董事	陳鴻霖	0	0	0	0
董事	蘇顯騰	0	0	0	0
獨立董事	張光明	0	0	0	0
獨立董事	曾繼生	0	0	0	0
獨立董事	徐金鈴	0	0	0	0
海外事業處處長	陳啟華	0	0	0	0
財務、會計及公司 治理主管	林素真	(15,000)	0	0	0
利用他人名義	晨和投資有限公司 (李篤誠)	0	0	0	0
利用他人名義	博文投資股份有限公司 (林文欽)	0	0	0	0

(二)董事、經理人及大股東股權質押變動情形:上表董事將股權質押之對象均為非關係人。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114 年 5 月 1 日/單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義合計 持有股份		前十大股東相互間 具有關係人或為配 偶、二親等以內之親 屬關係者，其名稱或 姓名及關係		備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱或 姓名	關係	
李 篤 誠	4,622,950	9.06%	1,523,592	2.99%	6,827,517	13.39%	郭馨芳 李家瑄 李家忻 晨和投資 有限公司	配偶 一等親 一等親 該公司 董事長	—
晨和投資 有限公司 代表人： 李篤誠	6,827,517	13.39%	—	—	—	—	李篤誠	該公司 董事長	—
葛 長 林	3,612,520	7.08%	—	—	—	—	—	—	—

韓商即時益公司 代表人： 權相俊	3,503,807	6.87%	—	—	—	—	—	—	—
林文欽	1,682,003	3.30%	514,444	1.01%	784,000	1.54%	博文投資股份有限公司	該公司董事長	—
李家瑄	1,656,260	3.25%	—	—	—	—	李篤誠 郭馨芳 李家忻	一等親 一等親 二等親	—
郭馨芳	1,523,592	2.99%	—	—	—	—	李篤誠 李家瑄 李家忻	配偶 一等親 一等親	—
李家忻	1,523,408	2.99%	—	—	—	—	李篤誠 郭馨芳 李家瑄	一等親 一等親 二等親	—
花旗託管 瑞銀歐洲 S E 投資 專戶	1,105,000	2.17%	—	—	—	—	—	—	—
董宗昆	842,000	1.65%	—	—	—	—	—	—	—

八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

114年3月31日；單位：股

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
贊鴻實業股份有限公司	500,000	100 %	—	—	500,000	100 %
Zen Voce (Pg) Sdn. Bhd.	1,000,000	100 %	—	—	1,000,000	100 %
Zen Voce Manufacturing Pte Ltd.	1,000,000	100 %	—	—	1,000,000	100 %
Solution Integration Pte Ltd.	2,659,000	100 %	—	—	2,659,000	100 %
科榮股份有限公司	8,676,501	65.68%	—	—	8,676,501	65.68%
博磊精密設備(蘇州)有限公司	—	—	—	100 %	—	100 %

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

截至 114 年 5 月 23 日年報刊印日/單位：仟股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普通股	51,006	38,994	90,000	皆屬上櫃掛牌股票

截至 114 年 5 月 23 日年報刊印日；單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	其他
88 年 04 月	10	500	5,000	500	5,000	公司設立	—	註 1
89 年 07 月	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資 15,000 仟元	—	註 2
90 年 10 月	10	2,400	24,000	2,400	24,000	現金增資 1,400 仟元 盈餘轉增資 2,600 仟元	—	註 3
91 年 09 月	10	6,394	63,946	6,394	63,946	現金增資 37,680 仟元 盈餘轉增資 1,920 仟元 員工紅利轉增資 346 仟元	—	註 4
92 年 11 月	10	11,000	110,000	11,000	110,000	現金增資 18,479,140 元 盈餘轉增資 15,027,310 元 員工紅利轉增資 1,676,730 元 資本公積轉增資 10,870,820 元	—	註 5
93 年 10 月	10	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資 22,500 仟元 盈餘轉增資 11,000 仟元 員工紅利轉增資 1,000 仟元 資本公積轉增資 5,500 仟元	—	註 6
94 年 10 月	10	17,000	170,000	17,000	170,000	盈餘轉增資 15,000 仟元 員工紅利轉增資 5,000 仟元	—	註 7
95 年 11 月	10	31,000	310,000	31,000	310,000	現金增資 110,000 仟元 盈餘轉增資 25,500 仟元 員工紅利轉增資 4,500 仟元	—	註 8
95 年 12 月	10	45,000	450,000	40,000	400,000	現金增資 90,000 仟元	—	註 9

96年07月	10	62,000	620,000	60,100	601,000	盈餘轉增資 28,000 仟元 員工紅利轉增資 13,000 仟元 資本公積轉增資 160,000 仟元	—	註 10
101年11月	10	90,000	900,000	57,095	570,950	註銷庫藏股 30,050 仟元	—	註 11
102年09月	10	90,000	900,000	45,676	456,760	減資 114,190 仟元	—	註 12
104年03月	10	90,000	900,000	51,776	517,760	現金增資 61,000 仟元	—	註 13
108年03月	10	90,000	900,000	51,006	510,060	註銷庫藏股 7,700 仟元	—	註 14

註 1：業經臺灣省政府建設廳 88.04.09 經授八八建三乙字第 151070 號函核准在案。

註 2：業經行政院經濟部商業司 89.07.19 經授中字 089463448 號函核准在案。

註 3：業經行政院經濟部商業司 90.10.12 經授中字 09032907400 號函核准在案。

註 4：業經行政院經濟部商業司 91.09.18 經授中字 09132722530 號函核准在案。

註 5：業經行政院經濟部商業司 92.11.4 經授中字 09232905450 號函核准在案。

註 6：業經行政院經濟部商業司 93.10.14 經授中字 09332864150 號函核准在案。

註 7：業經行政院經濟部商業司 94.10.26 經授中字 09433055490 號函核准在案。

註 8：業經行政院經濟部商業司 95.11.2 經授中字 09533065910 號函核准在案。

註 9：業經行政院經濟部商業司 95.12.11 經授中字 09533264700 號函核准在案。

註 10：業經行政院經濟部商業司 96.08.14 經授商字 09601196790 號函核准在案。

註 11：業經行政院經濟部商業司 101.11.16 經授商字 10101212740 號函核准在案。

註 12：業經行政院經濟部商業司 102.09.17 經授中字 10233893570 號函核准在案。

註 13：業經行政院經濟部商業司 104.03.19 經授商字 10401049500 號函核准在案。

註 14：業經行政院經濟部商業司 108.03.28 經授商字 10801032590 號函核准在案。

(二)主要股東名單：持有股份達總額 5%以上或股權比例佔前十名股東名單

114 年 4 月 15 日/單位：人；股

主要股東名稱	持 有 股 數	持 有 比 例
晨和投資有限公司	6,827,517	13.39%
李篤誠	4,622,950	9.06%
葛長林	3,612,520	7.08%
韓商即時益公司	3,503,807	6.87%
林文欽	1,682,003	3.30%
李家瑄	1,656,260	3.25%
郭馨芳	1,523,592	2.99%
李家忻	1,523,408	2.99%
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	1,105,000	2.17%
董宗昆	842,000	1.65%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 本公司於公司章程中訂定之股利政策如下：

(1) 第十九條條文：

本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之五至百分之十二作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。

(2) 第十九條之一：本公司為因應業務拓展之需求及產業成長，得依公司整體資本預算規劃所需資金，適度發放股票股利或現金股利，其中現金股利不得低於一成為原則，實際發放比例則授權董事會依公司營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化予以訂定。

2. 本年度擬議股利分配之情形

本公司一一三年度盈餘分配表如下表所示，一一三年度稅後盈餘計新台幣 30,833,428 元，擬發派股東現金股利 25,503,000 元(每股 0.5 元)。

單位：元

博磊科技股份有限公司		
盈餘分配表 113 年度 單位：新台幣(元)		
項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		149,051,185
113 年度稅後淨利	30,833,428	
本期稅後淨利以外項目：		
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(113 年度))	1,204,580	
113 年稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當		181,089,193

年度未分配盈餘之數額		
提列項目：		
減：提列 10%法定盈餘公積		(3,203,800)
可供分配盈餘小計		177,885,393
分配項目：		
股東紅利-現金(0.50 元)	(25,503,000)	
股東紅利-股票(0 元)	(0)	(25,503,000)
期末未分配盈餘		NT\$152,382,393
本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。		

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及酬勞之成數或範圍：

(1) 第十九條條文：

本公司年度如有稅前獲利，應提撥百分之五至百分之十二作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留之。

(2) 第十九條之一：本公司為因應業務拓展之需求及產業成長，得依公司整體資本預算規劃所需資金，適度發放股票股利或現金股利，其中現金股利不得低於一成為原則，實際發放比例則授權董事會依公司營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化予以訂定。

2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司年度應付員工酬勞及董監酬勞估列數係依法令、章程及過去經驗按擬發放盈餘之估計。股東會決議之實際發放金額有變動時，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工酬勞，股票紅利股數以決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值為計算基礎。

3. 董事會通過分派酬勞等資訊：

- (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

本公司 114 年 3 月 11 日第十屆第五次董事會決議，擬按公司章程分派 113 年度員工酬勞及董監事酬勞如下：

A. 員工紅利 3,594,471 元，全數以現金發放。

B. 董事酬勞 0 元。

- (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司 114 年 3 月 11 日第十屆第五次董事會決議不分派員工股票紅利，故擬議以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例為 0%。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司民國一一二年度員工現金酬勞新台幣 3,162,428 元及董事酬勞新台幣 910,000 元，該金額係業經民國一一三年三月七日董事會通過及經民國一一三年六月十一日股東會決議通過。

(六)買回本公司股份情形：

公司買回本公司股份情形

114年5月23日

買 回 期 次	第 一 次	第 二 次	第 三 次 (註3)	第 四 次	第 五 次 (已執行完畢)
買 回 目 的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
買 回 期 間	97/8/28~ 97/11/27	98/4/1~ 98/4/30	101/12/6~ 102/3/6	104/8/14~ 104/10/13	107/11/09~ 108/01/08
買 回 區 間 價 格	7.5~14.0，低於 7.5元仍繼續買回	2.5~4.0，低於 2.5元仍繼續買回	6.3~13.0，低於6.3 元仍繼續買回	12.0~24.0，低於 12.0元仍繼續買回	9.77~15.00，低於 9.77元仍繼續買回
已買回股份種類及數量	普通股/ 63,000股	普通股/ 2,942,000股	0股	普通股/ 523,000股	普通股/ 770,000股
已買回股份金額	442,632元	8,862,990元	0元	7,232,750元	11,472,121元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	註銷 63,000股 (註1、2)	註銷 2,942,000股 (註1、2)	--	轉讓 523,000股 (註4)	註銷 770,000股 (註5)
累積持有本公司股份數量	0股	0股	0股	0股	0股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%)	0%	0%	0%	0%	0%

註1. 本公司於97年8月28日至98年4月30日止買回本公司股票共計3,005,000股，上述庫藏股截至101年4月30日止已屆滿三年未轉讓予員工，故依法辦理註銷。

註2. 上述註銷之庫藏股減資基準日為101年8月31日，並已依法定程序向經濟部提出資本變更登記申請，於101年11月16日完成股票註銷。

註3. 本公司於101年12月6日董事會決議通過第三次買回庫藏股。基於維護整體股東權益與兼顧市場機制，本公司視股價變化及考量資金運用之效益，故未執行。

註 4. 本公司於 107 年 6 月 5 日第七屆第十七次董事會決議通過依本公司「104 年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定，轉讓買回股份予員工。已於 107 年 8 月 10 日將庫藏股票 523,000 股全數轉讓予員工。

註 5. 庫藏股減資基準日為 108 年 3 月 14 日，並已依法定程序向經濟部提出資本變更登記申請，於 108 年 3 月 28 日完成股票註銷。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：不適用。

三、特別股辦理情形：不適用。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工認股權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一) 計劃內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

(二) 執行情形：就前款之各次計劃之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容如下：

- (1) 自動控制設備工程業務。
- (2) 機械設備製造業務。
- (3) 電子零組件製造業務。
- (4) 一般儀器製造業務。
- (5) 電子材料批發及零售業務。
- (6) 精密儀器批發及零售業務。
- (7) 機械安裝及批發業務。
- (8) 產品外觀設計業務。
- (9) 國際貿易業務。
- (10) 電子資訊供應服務業務。

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度		112 年度	
	金額	比重	金額	比重
測 試 產 品	304,122	22.07	236,646	16.20
設 備 產 品	895,076	64.94	1,059,003	72.50
維 修 收 入	175,636	12.74	158,370	10.84
其 他	3,398	0.25	6,732	0.46
合 計	1,378,232	100.00	1,460,751	100.00

3. 公司目前之商品（服務）項目

- (1) 半導體測試治具。
- (2) 半導體測試介面板。
- (3) 積體電路預燒用測試連接座。
- (4) 積體電路測試用測試連接座
- (5) 晶圓、基板切割機。
- (6) 晶圓、基板半自動、全自動清洗機。
- (7) 切割週邊設備、零件供應及維修。
- (8) 植球機及植球機治具、零件之供應及維修。
- (9) 毒氣偵測設備。
- (10) 量子電腦設備。

4. 計畫開發之新商品（服務）：

目前主力產品以測試產品、切割機及 IC 封裝植球機為主，測試產品方面以爭取為邏輯 IC 廠商需求設計探針卡(Probe Card PCB)及載板(Load Board)等產品認證機會；隨著全球產業市場對於自動化需求與日俱增趨勢，本公司在設備機台方面以推展

新型全自動機台銷售為主，並有效運用本公司為客戶產品需求設計及開發之整合規劃能力，期使公司主力產品種類齊全，而有助於開拓及掌握未來商機。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

(1)半導體產業

資策會產業情報研究所(MIC)針對半導體產業趨勢預測，2024 至 2025 年全球半導體市場持續高度成長，創下 2018 年以來新高峰，其中，記憶體價格回溫與 AI 需求將為兩大成長動能。MIC 產業顧問分析，觀測 2024 年半導體市場成長，超過八成為記憶體產值所帶動，AI 需求約占一成多，展望 2025 年，記憶體仍居五成左右成長動能，不過 AI 已占四成左右，除此，資訊與通訊應用別的邏輯晶片的成長動能也值得留意。

AI PC 與 AI 手機動能值得期待 半導體結合 AI 再造全球科技生態系

資策會 MIC 預估，2024 年臺灣半導體產業產值將達 4.76 兆新台幣，成長 21.3%，隨著主流資通訊產品回穩與成長，為個別次產業帶來成長動能，預估晶圓代工成長 28%、IC 設計成長 15%、記憶體/IDM 成長 18%，以及 IC 封測成長 6%。展望 2025 年，先進晶片將持續引領臺灣半導體產值成長，預估 2025 年臺灣半導體整體產值將成長 15.9%，達 5.52 兆新台幣，次產業如晶圓代工預估成長 18%、IC 設計成長 14%、記憶體/IDM 成長 15%以及 IC 封測成長 10%。產業顧問表示，從 2023 年至 2024 年 Cloud AI 的發展，以及 2024 下半年至 2025 年由 AI PC 與 AI 手機帶動的 Edge AI 影響擴大，都將為臺灣供應鏈帶來商機。

展望半導體產業的中長期發展趨勢，資策會 MIC 產業顧問進一步指出，隨著 AI 演算法、GenAI 逐漸成熟，AI 智慧將朝向服務化發展，導入在資訊科技、自動駕駛、綠能永續與各行各業，並配合各國需求推動在地化，當 AI 更在地化且結合各產業，將有更多區域性 AI 服務商出現，並建立在地價值鏈，而形成規模的 AI 智慧應用產業將逐漸建立能量，推出自有的、本土的晶片解決方案，來達到更高的自主性，帶來更多的客製化方案商機。這股由半導體結合 AI 的發展方向，將推動全球科技生態系的變革與再造，催生產業價值鏈的創新變化。另外值得注意的是，隨著 AI 更加落實甚至可代理決策，預期 2026 年之後半導體市場將受到更多 AI 治理相關的政策性因素影響。

AI 應用將加速邏輯晶片、記憶體與封裝技術發展

資策會 MIC 表示，全球半導體市場由 ICT 需求轉變為 AI 應用為主要成長動能，在 AI 晶片需求爆炸性成長之下，預估全球半導體市場將在 2027 年達到 7,000-8,000 億美元規模，且業界已有共識認為 2030 年市場可望突破 1 兆美元。資深產業分析師表示，目前大型語言模型(LLM)為 AI 核心應用之一，LLM 參數量的大幅成長，提升對底層晶片的算力要求，且記憶體頻寬、資料傳輸效率與散熱設計皆面臨挑戰，進而推動 AI 晶片/專用加速器如 GPU、TPU、專用 ASIC 晶片發展，以求能更符合 LLM 需求。

資策會 MIC 資深產業分析師進一步表示，AI 應用將加速邏輯晶片、記憶體與封裝技術發展，為滿足不同的 AI 應用場景，邏輯晶片、記憶體、I/O 與封裝

技術，將需要在性能、功耗與體積之間取得平衡。為求晶片整體性能與功耗效率提升，晶片產業展開變革，技術進步體現於邏輯晶片運算能力、記憶體頻寬、容量與延遲表現，另外，先進封裝技術在整合運算晶片與記憶體方面也扮演關鍵角色，反映出現代電子設計面臨的挑戰，半導體技術整合也更加關鍵。

2025 年 AI PC、AI 手機滲透率達 16.8%、25% 帶動相關零組件升級

隨著 GenAI 逐漸落地終端，資策會 MIC 發布終端產品 AI PC 與 AI 手機預測，關於 AI PC，2025 年全球 AI PC 滲透率將達 16.8%，全球出貨量 4,400 萬台，資深產業分析師表示，算力達到 40TOPS 以上的處理器集中在 2024 年下半年推出，因此 2024 年 AI PC 滲透率仍偏低，預期 2025 年隨著下一代 AI 處理器與 Arm 架構處理器產品推出，將驅動 AI PC 滲透率提升，預期在 2028 年突破六成，全球出貨達 1.63 億台。針對 AI 手機，2024 年 GenAI 應用成為各大手機品牌主軸，導入到旗艦與高階機種，預估 2024 年全球 AI 手機市場滲透率可達 13%，全球出貨 1.56 億支。展望 2025 年，預估全球 AI 手機市場滲透率達 25%，全球出貨 3.03 億支，預期 2026 年 AI 手機將滲透至中低階機種，全球滲透率將在 2028 年突破六成。

展望 AI PC 與 AI 手機發展，資策會 MIC 資深產業分析師提出三大趨勢，首先，AI PC 與 AI 手機發展將推動相關零組件升級，除了關鍵處理器提供更高算力，記憶體也是一大關鍵，如 PC 的 DRAM 須升級至 16GB，而手機依據不同作業系統呈現差異，最少需要 8GB，不僅如此，記憶體本身設計也須大幅改變，才能因應未來 GenAI 手機的進一步需求。除此，散熱元件須確保 PC 與手機運作的穩定性，大廠開始規劃導入不同的散熱解決方案，帶動相關供應鏈發展。第二，AI PC 應用發展出現一個世界、兩套系統，中國大陸因其國產化政策、語系差異及 AI 應用的審查制度，自行發展出一套 AI PC 生態系統。觀測全球與中國大陸在優勢市場的差異，全球供應鏈優先布局商用領域 AI 應用、中國大陸則為生態系串接大量消費層級 AI 應用；第三，未來 PC AI 功能可能邁向收費制，而 Apple、三星 AI 手機皆可能最終朝向進階 AI 功能收費服務模式發展。

(2) 記憶體產業

根據市研公司 TrendForce 分析，受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格，加上 HBM 等高附加價值產品崛起，預估 DRAM 及 NAND Flash 產業 2024 年營收年增幅度將分別增加 75%和 77%。而 2025 年產業營收將持續維持成長，DRAM 年增約 51%、NAND Flash 年增則來到 29%，將創歷史新高，並且推動資本支出回溫、帶動上游原料需求，惟記憶體買方成本壓力將隨之上升。

DRAM 方面，預估受惠於 DRAM 均價在 2024 年增加 53%、2025 年增加 35%的條件下，進一步推升 2024 年 DRAM 營收達 907 億美元、年增 75%，2025 年達 1,365 億美元、年增 51%。TrendForce 表示，4 項驅動 DRAM 營收的因素包括 HBM 崛起、一般型 DRAM 產品世代演進、原廠資本支出限縮供給和 Server 需求復甦。相較一般型 DRAM，HBM 除拉升位元需求，也拉高產業平均價格。預估 2024 年 HBM 將貢獻 DRAM 位元出貨量 5%、營收 20%。此外，DDR5 和 LPDDR5/5X 等高附加價值產品的滲透同樣有助提高平均價格。TrendForce 估計，DDR5 將分別貢獻 2024、2025 年 server DRAM 位元出貨量 40%、60-65%，LPDDR5/5X 會貢獻 2024、

2025 年 mobile DRAM 位元出貨量 50% 和 60%。

NAND Flash 方面，2024 年 NAND Flash 營收將達 674 億美元、年增 77%；2025 年在大容量 QLC Enterprise SSD 崛起、smartphone 採用 QLC UFS、原廠資本支出限縮供給和 server 需求復甦等 4 項因素帶動下，NAND Flash 營收將達 870 億美元、年增 29%。北美 CSPs 已開始在 inference AI server 大量採用 QLC enterprise SSD，尤其是大容量規格。TrendForce 預估，QLC 將貢獻 2024 年 NAND Flash 位元出貨量 20%，此比重 2025 年將再提升。在 smartphone 應用，QLC 預計逐步滲透 UFS 市場，部分中國 smartphone 業者預計於 2024 年第四季起採用 QLC UFS 方案，Apple 則預計 2026 年開始導入至 iPhone。

記憶體產業營收創紀錄下，原廠將有足夠現金流加速投資。預估 2025 年 DRAM、NAND Flash 產業資本支出分別年增 25%、10%，且有機會上修。此外，記憶體生產規模提升將帶動對矽晶圓、化學品等上游原料需求，但相反的，記憶體價格上漲將增加電子產品成本，ODM/OEM 業者較難完全將成本反映在零售價上，利潤勢必將被壓縮，終端銷量也可能受到壓抑，導致需求下滑。DRAM 產業歷經 2024 年前三季的庫存去化和價格回升，價格動能於第四季出現弱化。TrendForce 資深研究副總表示，由於部分供應商在 2024 年獲利後展開新增產能規劃，預估將推升 2025 年整體 DRAM 產業位元產出年增 25%，成長幅度較 2024 年為大。另 TrendForce 也在 2025/3/26 出具最新調查指出，NAND Flash 原廠自 2024 年第四季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品牌商因應美國可能提高關稅而提前生產，帶動需求，加上 PC、智慧手機和資料中心等應用領域已開始重建庫存，預計 2025 年第二季 NAND Flash 價格將止跌回穩。其中，client SSD 歷經連續三個季度的庫存去化，隨著 OEM 廠商提前生產，第二季將出現庫存回補需求。預期 Windows 10 停止支援和新一代 CPU 將帶動 PC 換機潮，加上 DeepSeek 效應助益 edge AI 普及，刺激 client SSD 需求。而原廠以減產和調整供貨策略逐步達成供需平衡，預期第二季 client SSD 合約價將季增 3% 至 8%。

根據 TrendForce 最新調查，DRAM 產業結構越趨複雜，除既有的 PC、server、mobile、graphics 和 consumer DRAM 外，又新增 HBM 品項。從地緣角度分析，近年中國供應商的產能快速成長，預期將造成供給版圖變化。TrendForce 資深研究副總指出，三大 DRAM 原廠中，SK hynix 因 HBM 產品大幅提升獲利，2025 年新增產能幅度最大。預估 2025 年整體 DRAM 產業位元產出將增加 25%，若扣除中國供應商的供給，年增幅度將略減為 21%。然目前中國業者的產出絕大多數提供給本地客戶，供應至海外地區的比例微小。

得益於 AI 需求，HBM 成為 DRAM 產業重要驅動力。如排除 HBM 產品，2025 年一般型 DRAM (Conventional DRAM) 位元產出預計年增 20%；當扣除 HBM 和中國業者的供給，即只看三大原廠的 conventional DRAM 位元產出，預估明年將年增 15%，於歷年情況中屬偏低水位。一般而言，一般型 DRAM 包含 DDR5、DDR4、LPDDR4/5，以及 graphics 和 consumer DRAM。TrendForce 指出，2025 年整體 DRAM 產業位元供給充足，若需求不如預期，供應商易面臨跌價壓力。在地緣考量下，中國的 DRAM 供給達成率將高於其他地區，以使用舊製程的 LPDDR4x 與 DDR4 為主，這兩項產品的價格壓力將遠高於其他類別。此外，明年 HBM 供貨將持續吃緊，以 HBM3e 情況最嚴重。

GII 市研公司分析，全球半導體記憶體市場預計將從 2025 年的 1,149.81 億美元成長到 2030 年的 3,253.45 億美元，預測期內的複合年成長率為 23.12%。

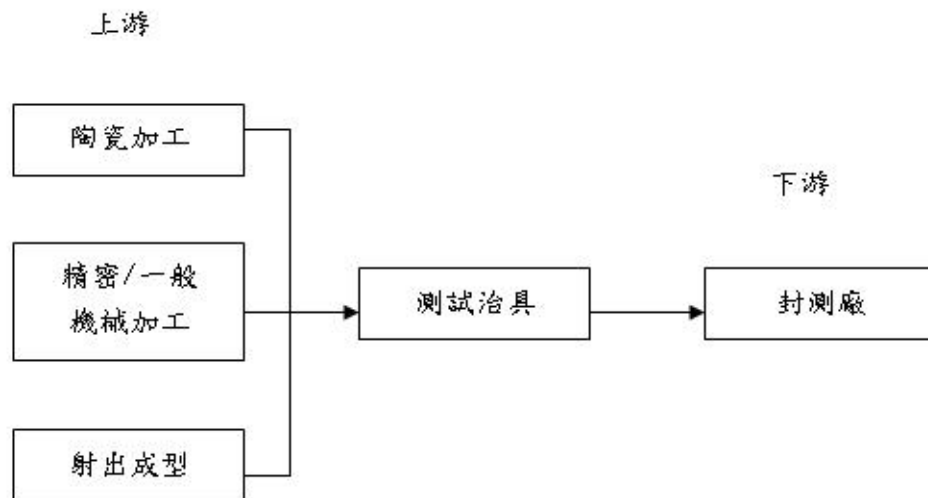
半導體元件在汽車、家電、IT/通訊等各行業的應用日益廣泛，預計將推動全球市場的成長。半導體是使用積體電路（IC）技術作為電腦記憶體和晶片的重要電子設備。半導體技術的進步，例如精製程序、能源效率和晶片容量的最佳化，為適合各行業的創新記憶體解決方案打開了大門。

此外，智慧型手機和其他行動裝置的普及對高效能晶片產生了前所未有的需求，這些晶片可以透過提供無縫的用戶體驗、快速的應用程式載入時間和無縫的多工功能來滿足現代用戶不斷變化的需求和願望。例如，根據 IDC 全球與前一年同期比較手機追蹤報告，預計 2023 年印度智慧型手機市場出貨量將達到 1.46 億台，年成長率為 1%。上半年大幅下降了 10%，但下半年卻比去年同期成長了 11%。4Q23 出貨量總計 3,700 萬台，較去年同期成長 26%。這主要由於下半年出貨量高於預期，包括推出了幾款新機型。穿戴式裝置、智慧型手機和電子產品等創新產品積極採用以記憶體為中心的組件也推動了市場成長。此外，電子和汽車產業對 DRAM 和 Flash ROM 等半導體裝置的依賴日益增加，也推動了對整合晶片和裝置的需求。

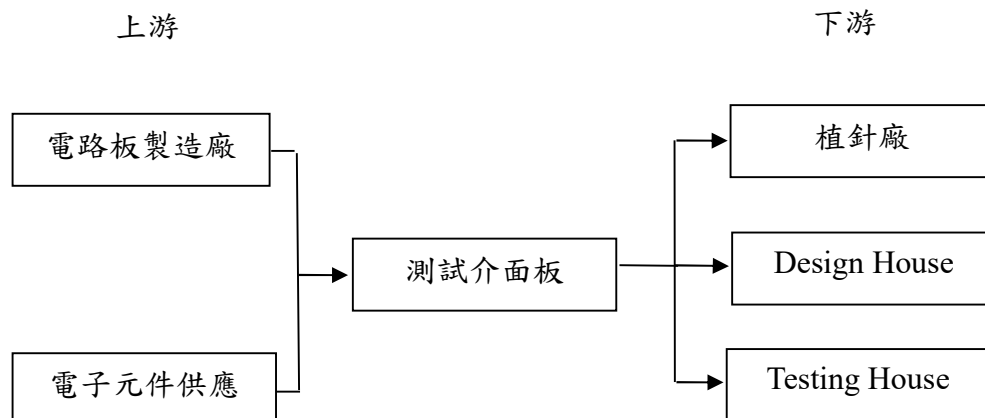
全球對智慧型設備、家電、智慧型手機和工作站的需求凸顯了對具有先進技術的晶片的需求。因此，市場正在經歷顯著擴張的時期，為該領域的公司提供了許多商機。

2. 產業上、中、下游之關聯性

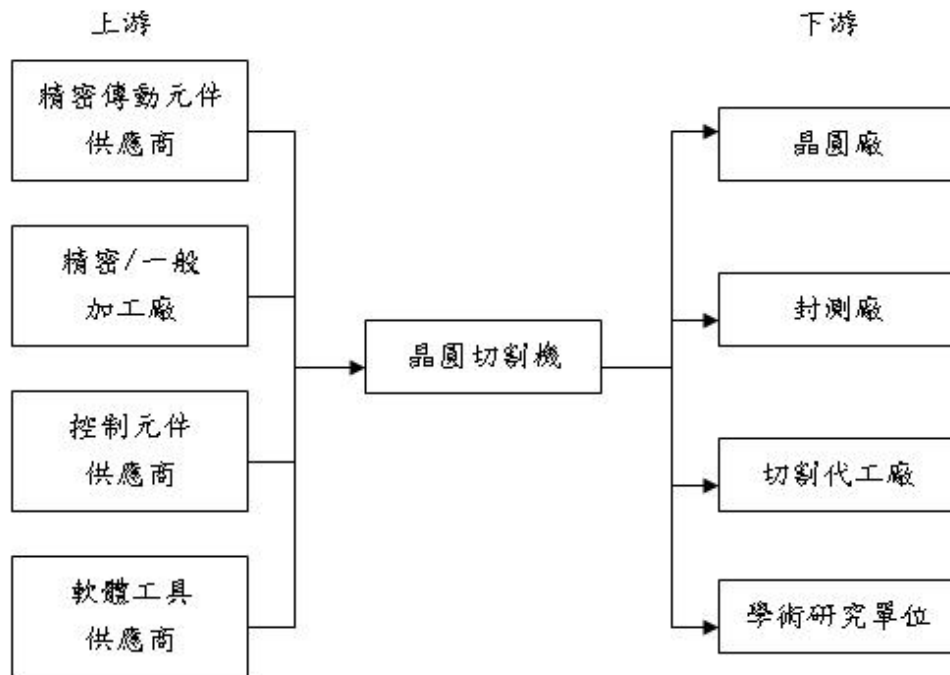
(1) 半導體測試治具(Change Kit)



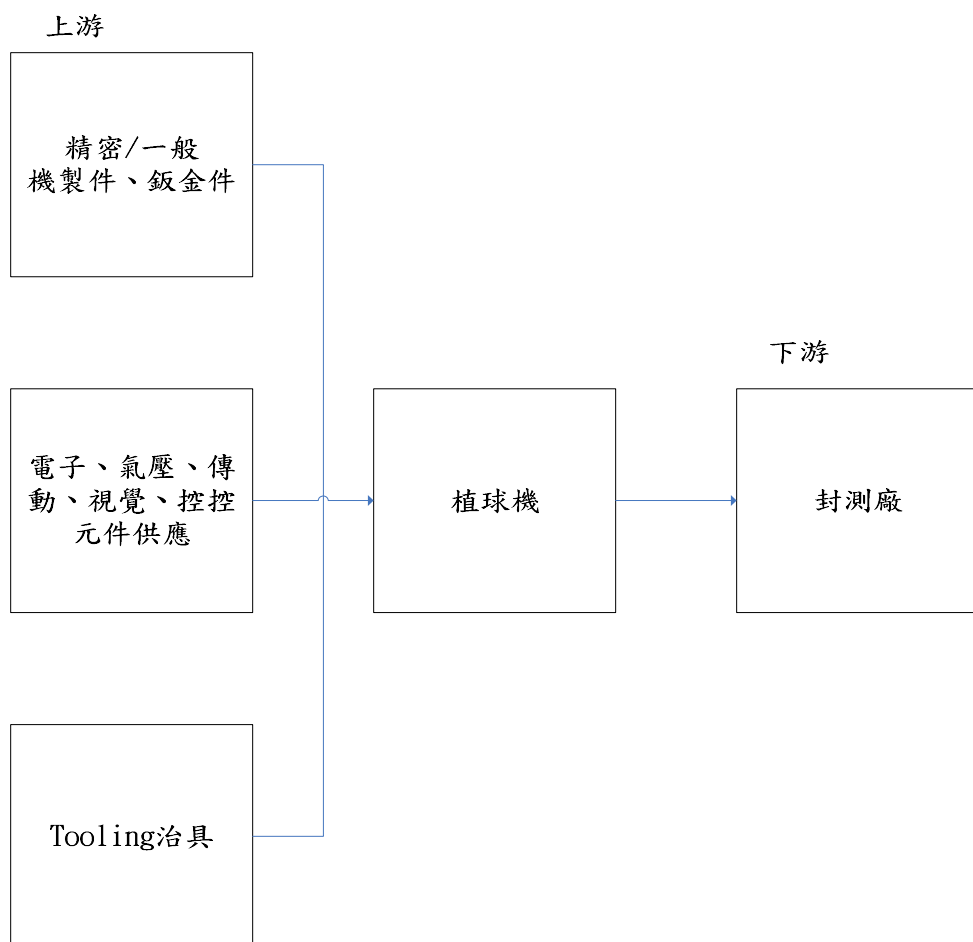
(2) 半導體測試介面板(Hifix, Load Board, Probe Card PCB)



(3) 晶圓切割機



(4) 植球機



3. 產品之發展趨勢及競爭情形

本公司屬半導體下游封裝測試所需治具、介面之測試產品，以及相關設備製造及代理商，茲就相關產業之未來發展趨勢及競爭情形說明如下：

(1) 半導體產業技術將持續進化

隨著技術的創新及成本效益的需求，半導體的製程已由已由 90nm 微縮到 3nm，晶圓尺寸則由 2 吋逐漸加大而目前更朝向 18 吋演進，新的製程及晶圓尺寸的擴大也讓半導體廠持續對相關的製造設備有更新的需求。而在手持式智慧裝置需求持續上升、寬頻及無線網路之逐漸普及、資料雲端化之趨勢下，未來對半導體之功能性也將複雜化，而設備業者除了須配合半導體廠的產能擴大及規格之更新，也需持續提昇設備之穩定性。

而在半導體產業下游之封裝測試技術部份，覆晶封裝將成為未來之趨勢。由於手持行動裝置、記憶體及其他類消費型電子對於銅柱凸塊及微凸塊之需求漸增，再加上該封裝法可配合最新之 3D IC 與 2.5D IC 製程，該封裝技術所帶來晶片之尺寸縮小、低訊號干擾、電性佳、最低連接電路損耗、散熱性優異等優勢，使得消費性電子商品強調輕薄及功能強大之趨勢得以實現，然而該封裝法強調高腳數及細間距之規格也考驗封裝測試設備供應商之技術能力。

(2) 全球半導體封測市場競爭加遽

台灣於全球半導體封測市場雖已有過半之市佔率，但其它國家如美國、新加坡、日本、馬來西亞及中國仍然對這塊市場虎視眈眈。中國已明確指出強化 IC 封測產業之方向，鼓勵內地廠商投入設備材料國產化以降低中國封測業成本；新加坡政府則持續補助封測設備材料成本，並鼓勵外資投資封測及周邊產業；日本目前已整合 IDM 大廠成立全球第五大 IC 封測公司 J-Device 而美廠 Amkor 也藉由入股 J-Device 達成策略聯盟之目的；馬來西亞則持續強攻中低階封測市場，透過擴大產能強化其議價能力。因此，台灣之半導體封測業者目前雖然全球市佔率已超過 50%，但面臨未來各國之強大競爭，勢必將持續開發先進技術確保競爭優勢並避免淪於價格競爭，而國內相關設備業者，在近幾年在產品技術上逐漸趕上國外水平，加上價格較具競爭力於內銷市場已小有成果，未來於外銷市場亦有發展機會。

(3) 半導體設備之國產化

台灣身為全球半導體生產重鎮，每年對設備之更新及後續技術服務之需求量相當可觀。然而，由於許多半導體設備關鍵技術皆掌握在國外大廠手上且具有專利權保護，故過去總為國外大廠壟斷，即便台廠想介入也僅能從經營代理權著手。然而近年來許多國內原先之代理商開始藉由與半導體大廠之合作經驗開始跨足設備自製，而台灣半導體大廠亦有鑒於三星因韓國政府扶植設備國產化而享有之成本優勢，提高與本土設備製造商之合作研發並提高國產設備接受度，因此未來幾年隨著半導體市場之持續成長及台灣每年龐大之設備支出，國產設備之供應商也將隨之受益。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	113 年度	截至 114/4/30
研發費用	98,367	29,262

2. 開發成功之技術或產品

年度	研發成果
98 年度	1. 完成高頻記憶體 IC(DDR3)的測試介面板之設計、開發、量產、銷售。 2. 成功設計高頻之邏輯測試介面板，傳輸速度高於 2Gbps，將繼續往更高傳輸速度發展及設計。 3. 針對輕、薄、小的產品特性，成功開發 TSSOP8(3x4.5) 之整體解決方案。 4. 提昇切割機視覺對位效率。
99 年度	開發完成高頻記憶體 IC(DDR3) 並測數 128 顆 IC 的測試介面板。
100 年度	1. 完成 M6300 之 Change Kit 之設計、開發、量產、銷售，用於 DDR DRAM 之 IC 測試，使其達到最高並測數 256 顆/測試頭。。 2. 量產並測數最高達 1152 sites 測試介面，用於 Nor Flash 之晶圓測試 並達到並測數最高 1152 sites 之水平。 3. 搭配客戶之需求，完成 Driver & IO Shared Socket Board 設計驗證，用於記憶體 IC 測試，可使測試機的並測數倍增，進而降低客戶之測試成本。
101 年度	1. IC 分裝機（挑揀分類機）：將植球的裝置經由自動化動作置入 IC 包裝盤。 2. 設計開發並量產記憶體驅動 IC 之晶圓測試介面板，主要為增加晶圓測試點數。 3. 投入高速記憶體測試機 T5503 測試介面板之設計，主要提供記憶體 IC 測試。 4. 成功設計 USB 3.0 高頻之邏輯測試介面板，將繼續往更高傳輸速度發展及設計，主要提供邏輯 IC 測試。 5. 完成新測試平台 M1 SSV 之晶圓測試介面板之開發、量產、銷售。主要提供晶圓測試，主要提供晶圓測試。 6. 全自動切割機(Jig Saw Engine)：雙主軸，雙工作盤，基板切割機

年度	研發成果
102 年度	1. 更新型植球機能對更小球徑(0.10~0.15mm)的產品做植球，相較於業界水準(0.2mm)更為先進。 2. 在 ATI 的測試平台 T5371/5585/5593 成功開發及量產並測數倍增之測試介面。主要提供記憶體 IC 測試。 3. 成功開發及量產測試平台型號 Kalos 之晶圓測試介面版，使其並測數達 256 顆晶圓。 4. 完成測試平台型號 HP93000 Pin Scale 之 IC 測試介面板之開發、量產、銷售，主要提供邏輯 IC 測試。 5. 全自動切割機(Tape Saw Engine)：結合搬運、切割、清洗功能，能夠用來切割晶圓。 6. 半自動切割機：針對舊型機台強化多方面功能，使該機台之軟體及硬體設計更加使用者導向。
103 年度	1. 半自動雙刀切割機：針對客戶在多工件切割提供高性價比產品。 2. 測試介面 (Hi-Fix)：在 ATI 的測試平台 T5503 成功開發及量產測試介面。主要提供記憶體 IC 測試。 3. 測試介面 (Change Kit)：在 ATI 的分類機平台 M6242 成功開發及量產 512Dut 測試介面。主要提供記憶體 IC 測試。 4. 設計開發完成 High Pin FBGA 1444L 31x31x2.14 測試座。 5. 設計開發完成 fine pitch 0.35 mm pitch QFN 測試座。 6. 設計開發完成 small package DFN4L 1x1 Kelvin contact 測試座。
104 年度	1. 全自動切割機(Tape Saw Engine): 甲、完成高定位精度(<±1um)的雙主軸切割機，主要提供雙刀的切割應用，降低背崩的產生。 乙、導入線上磨刀功能。主要應用於 RDL 及封裝 2. 設計開發完成 Singulation kit。主要為 Hami Singulation kit 與 ASM Singulation kit。 3. 設計開發完成 POP 封裝的 BGA 測試座 4. 設計開發完成以 PCB 測試載板來測試相對應的 IC 的測試治具 5. 設計開發完成 指紋辨識 IC 的測試座及測試載具 6. 設計開發完成 open top 型式的測試座及測試相對應的 PCB 測試模組 7. 設計開發完成 CR260x 系列 IC 測試座測試介面板。 8. 設計開發完成再 T5585 測試平台測試 DDRIII 產品的功能性測試介面

年度	研發成果
105 年度	1. 在 ATI 的測試平台 T55033 成功開發及量產並測數倍增之測試介面。主要提供記憶體 IC 測試。 2. 設計開發完成 Chroma 3380 系列 IC 測試座測試介面板。 3. 投入 ATI ND4 驅動 IC 測試平台 PCB 設計開發。 4. 完成 TW350 系列之 Change Kit 之設計、開發、量產、銷售，用於 DDR/MCP IC 測試，使其達到最高並測數 512 顆/測試頭。 5. 成功銷售 Singulation 設備。 6. 設計完成不沾黏與低靜電的 Singulation Kit。 7. 設計完成高平面度的 Jig Saw 工作盤，提供免 TAPE 的半自動設備切割方案。 8. 完成開發 POP 封裝的測試座，以及完成此測試座的工程驗證 9. 設計完成 Heatsink 測試置具，用於 high pin count 的 BGA 封裝的高溫測試 10. 設計開發完成 PCB 模組測試的專用測試置具，縮短使用者 troubleshooting 的工程驗證時程
106 年度	1. 將 ESBC Hi-Fix 架構整合至 T5385 Engineering Hi-Fix 上，提供客戶子母板概念，容易替換 IC 測試板，有效增加規格變更時的靈活性。 2. 完成 T5833 Engineering Hi-Fix 及 DSA Socket board 設計。 3. 完成 0.3mm pitch 386BGA 測試載板，解決客戶 Fine pitch 產品測試需求。 4. 成功研發 6A 電流規格 Power IC 測試載板，達成客戶 6A 電流規格。 5. 完成 ETS88 測試平台之 PCB 介面，提供 power 產品測試使用。 6. 完成 Loopback 6GHZ Speed 測試載板設計，解決客戶現有載板無法測試問題。 7. 完成 3360 OSL 1536 chanel 測試平台之 PCB 介面，提供高 Pin 數產品測試使用。 8. 成功研發完成 CP 產品以 VPC 介面測試，達成客戶 Fine pitch 產品測試需求。 9. 研發完成 ND4 TYP1 3584 chanel 測試平台之 PCB 介面，提供高速及高 Pin 數 CP 產品測試使用。 10. 投入 Teradyne J750EX-HD 邏輯 IC 測試平台 PCB 設計開發。
107 年度	1. 升級全自晶圓切割機功能 a. 佔地面積減少 10%，面寬減少 20%，機台重量降低 25%。 b. 微塵防護設計，全罩式機台，並搭配 FFU 與強水霧分離裝置，有效隔離外來物與抽離切割粉塵，清洗腔體與二流體噴嘴頭設計，更集中有效的沖洗晶圓上的微塵。 c. 採用新一代低震動與低偏擺的切割主軸，提高切割品質。 2. 開發 Panel Jig Saw a. 600mm X 600mm panel 級別的高精度切單機。 b. 搭配二流體、水刀設計，切割粉塵帶走不殘留。 c. 開發風刀移除產品上的水痕。 d. 開發 Pre-alignment 功能，縮短製程時間，增加產能。 3. 開發指紋辨識 IC 的基板半自動測試平台，提供客戶快速完整基

年度	研發成果
	板功能測試。 4. 開發 0.3mm pitch BGA package 產品的雙針測試座, 提供客戶對於 BGA 產品雙針測試的解決方案。 5. 開發 LED 照度測試置具, 提供客戶良好且易於操作的測試置具 6. 成功研發 T5503HS connector (T5593、T5503) 非穿透式之結合方法, 含 SMT 方式 與 魚眼 mounting pin, 以提供客戶 T5503HS DSA 之需求。 7. LP base 加工製程改善: 由原來的 CNC 加工方式改為 “鋁擠式” 成形, 大幅降低成本, 提升產品競爭力 8. 完成研發 T5830es 測試平台之 PCB 介面, T5830es 為工程開發使用機台, 提供記憶體客戶工程開發或樣品測試使用, 多家客戶有此需求。 9. 成功研發 T5503A Hifix 搭 M6541 Handler, 目前 T5503 標準規格為搭配 M6242 Handler, 博磊成功完成需求搭 M6541 提供客戶生產測試。 10. 成功研發 OVT 手機鏡頭產品在 E320 測試之 PCB 介面, OVT 為手機鏡頭產品主要生產者, 博磊成功完成 E320 PCB 介面為 OVT 合格供應商。 11. 完成 T6391 TYPE3 測試平台之 PCB 介面, 提供 LCD 產品高速及高接腳數產品測試使用。 12. 成功研發倍頻模組, 能在低速測試平台測試高速產品之功能, 目前已經推廣運用在 T5593 & T5833 機台上, 已有多家客戶有意進行開發。
108 年度	1. 成功研發 T5503HS Hifix 搭 M6242 Handler, T5503HS 滿足新一代 DDR4-SDRAM 與 LPDDR4-SDRAM 記憶體測試需求的解決方案, T5503HS 測試速度最高可達 4.5Gbps, 此速度足以因應現今資料傳輸速度記憶體 4.266Gbps 運作頻率, 博磊成功完成需求搭 M6242 提供客戶生產測試。 2. 成功研發 2.4Ghz RF 產品 Load board PCB 介面, 將提供 RF 產品客戶測試的解決方案。 3. 成功研發 LTX/Credence DX 測試平台之 Probe PCB 介面, 提供 LCD 產品高速及高接腳數產品測試解決方案。 4. 成功研發 Magnum5 測試平台之 Probe PCB 介面, Magnum5 測試系統提供靜態 RAM 存儲器和邏輯設備高並行測試效率, Magnum 最大的配置可提供多達 5120 通道, 提供 500MHz DDR 速率之產品測試使用。

年度	研發成果
109 年度	1. 提升晶圓切割機中的”破刀檢測功能”，能檢測出刀片更小破口，確保切割品質。 2. 提升晶圓切割機中的”刀刀磨耗量測功能”，大大提升檢出速度，以增加產能。 3. 提升晶圓切割機中的定位精度，在溫度變化 3°C 內，視覺重現精度 2um，切割精度 3um。 4. 提升晶圓切割機中的”清洗功能”。 5. 綜合以上功能的提升，晶圓自動切割機 1261+，可應用在 CMOS 產品的切割生產。 6. 完成晶圓切割機中的”切環功能”，除了直線切割外，亦可以進行圓形切割。 7. 完成晶圓切割機中的”磨邊功能”，除了直線切割外，亦可以進行邊料拋光。 8. 成功研發在 4.5Gbps 測試速度要求下，將訊號 1 share 4 方式達成訊號擴充，以開發出 256 dut DDR4 記憶體測試介面，提供客戶產能測試的解決方案。 9. 成功研發低電源之測試模組介面，改善 T5503HS 測試機在低電源狀態無法提供穩定電壓輸出，無法測試低電源記憶體問題，提供客戶低電源記憶體產品測試的解決方案。 10. 成功研發 24GHz 毫米波車用雷達測試板開發，提供車用雷達客戶測試的解決方案。 11. 在 Probe PCB 產品部份，成功開發 0.3mm pitch 128dut 垂直探針專板，提供客戶測試的解決方案。
110 年度	1. 成功研發 Chroma 3680 測試平台之 PCB 介面，提供 SOC 產品測試使用。 2. 成功研發 Ultra flex 測試平台之 PCB 介面，提供 SOC 產品測試使用。 3. 成功開發 6”/8” 全自動晶圓切割機，MODEL NAME “TS861”，應用在 4”、6”、8” 的晶圓切割。 4. 成功開發 6”/8”/12” 全自動高潔淨度晶圓清洗機 MODEL NAME “TCQ61” 與”TCH61”，應用在 6”、8”、12” 的晶圓清洗。 5. 開發無獨立溫控的預燒爐，IC 均溫可達+- 3 內。
111 年度	1. 完成 TS1231 開發，導入 EtherCAT 運動控制系統。 2. JS3061 Handler 導入 EtherCAT 運動控制系統。 3. 開發 TS1230/TS1231 3 吋刀功能，並完成客戶端驗證。 4. 完成 TCQ61 在 64M CIS wafer 清洗驗證，提升了二流體清洗與腔體防汙能力。 5. 開發全自動 Panel Jig Saw "JS6060"，此為 600mmX600mm panel 的高精度切單機加 Handler 組合，並在客戶端完成驗證。 6. 完成開發 JS3061 3D Inspection 功能。

年度	研發成果
112 年度	1. 高階測試平台 T5503HS2 DSA 的開發並在客戶端取得驗證通過，客戶認同此平台開發的成功，並獲得訂單 2. 開發高階測試所使用的 DSA connector，並取得台灣發明專利，大陸新型專利，產品技術卓越 3. 改善 Socket Board 的結構與 Via 尺寸，使得傳輸速度達到 DDR5 的規格(9Gbps)，提供客戶 DDR5 的解決方案。 4. 改善 RF Load Board 的設計，速度 60GHz 下，信號損耗降低 28%，提供客戶高速傳輸的解決方案。 5. 實現步進 circle cut 功能，完善 wafer edge trimming 能力，並完成客戶端實切驗證與量產。 6. 台製 2.4Kw 主軸開發完成，且完成客戶端驗證，已出貨給客戶。 7. JS3061 unloader to bin 功能開發完成，並完成客戶端驗證。 8. JS3061 自製 picker(10 支 picker 模組)開發完成，Dry run UPH > 25,000。
113 年度	1. 高階封裝 POP BGA 的測試解決方案完成並在客戶端驗證通過，客戶認同此方案並獲得訂單。 2. 開發 eMMC 測試的方案在測試平台 E320 上面，完成開發及測試，並獲得訂單。 3. 開發全自動 Panel Jig Saw "JS3062"，此為 250mmX250mm panel 全自動切割分選設備，並完成客戶端驗證。 4. 開發雙軸半自動晶圓級切割機 TS1230W，完成試切驗證，並獲得客戶訂單。

(四)長、短期業務發展計畫

1. 長期業務發展計畫

(1) 行銷策略

- A. 與客戶建立夥伴關係，成為客戶長期的切削解決方案的提供者。
- B. 拓展其他測試領域之國際客戶，發展以產業價值鏈上下游策略聯盟。
- C. 密切掌握市場資訊及客戶需求，積極尋找新設備供應商爭取獨家代理權，以配合產業之變化，並積極開發新興產業創造市場需求。

(2) 生產政策：研發生產設備、提升生產技術並加強品質管理，提供客戶高品質的產品。

(3) 產品發展方向

- A. 積極投入細微工程之研發，透過成功的產品開發，支援事業中心的營運。
- B. 發展其他測試領域之產品。
- C. 技術導向，提供客戶一流的產品與服務。

(4) 營運管理

- A. 經由其他客戶群及測試領域產品的開發銷售，使公司營運更多角化。
- B. 培養公司管理人才，厚植公司經營管理實力，以期永續經營。

2. 短期業務發展計畫

(1) 行銷策略

- A. 積極引進如特殊 IC 測試腳座、晶圓測試用探針卡等高單價、高利潤消耗性零組件，並積極與客戶簽訂年度耗材合約，以提升服務效率創造穩定利潤。
- B. 延伸至上游的晶圓切割封裝開發及驗證等領域，擴大產品線及所提供專業服務之廣度及深度。
- C. 擴展現有市場整合行銷通路，積極於潛在市場爭取更多的業務。
- D. 加強對現有客戶之服務，以保持長期合作關係。

(2) 生產政策

建立多樣化的生產能力及標準化作業程序，以因應客製化產品之要求。

(3) 產品發展方向

- A. 投入高頻產品測試的研發，發展優良的測試介面產品。
- B. 發展多樣化測試平台的測試介面產品。
- C. 對客戶產品提昇測試效益，對既有產品提出改善方案，並將之轉為營業利益。
- D. 開發新一代切割機與植球機，以擴大市場規模。
- E. 提供高性價比的產品，以強化競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度 銷售區域	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
台灣	995,113	68.12	1,038,221	75.33
中國	289,254	19.80	207,645	15.07
新加坡	32,510	2.23	18,078	1.31
美國	7,079	0.48	30,813	2.24
其他國家	136,795	9.37	83,475	6.06
合計	1,460,751	100.00	1,378,232	100.00

2. 市場占有率

本公司之產品主要提供半導體封裝測試介面及晶圓、LED 切割使用，而無論在半導體封裝測試或半導體、LED 產業所需之設備、耗材及零組件均種類繁多，市場上並無針對各類別品項之統計數字可供分析。相較於同業，由於國內設備廠商各有其專業領域，綜觀所有上市櫃半導體設備供應商均無與本公司擁有同類型產品線，因此較難在一致性基礎下評估其市場佔有率。

此外，由於本公司具備機電整合之技術能力，且經營團隊於半導體業界已有十數年經驗，專注於客戶關係之經營及提供完整的封測解決方案，逐步累積了競爭之根基，從本公司長期往來客戶多為國內外上市櫃知名之半導體廠商可得知，本公司之產品與同業間應仍具有其市場地位及競爭力。

3. 市場未來之供需狀況與成長

IDC 市研公司最新研究顯示，由於 2025 年全球人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景。

IDC 資深研究經理表示：「在 AI 持續推升高階邏輯製程晶片需求，以及高價 HBM 滲透率提升的推動下，預計 2025 年整體半導體市場將成長超過 15%；半導體供應鏈包括設計、製造、封測、先進封裝等產業，在上下游橫縱合作之下，將共創新一波成長契機。」



IDC 市研公司預測 2025 年半導體市場將具備下列八大趨勢：

(1) 2025 半導體：AI 驅動的高速成長仍將持續

2025 年半導體市場預計將成長 15%。記憶體領域可望成長超過 24%，主要動能來自 AI Accelerator 需要搭配的 HBM3、HBM3e 等高階產品滲透率持續提升，以及新一代 HBM4 預計於 2025 年下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長 13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如 AI 伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，另外成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。

(2) 亞太區 IC 設計市況升溫，2025 年可望再成長 15%

亞太 IC 設計業者產品線豐富多元，應用領域遍布全球，包含 Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC 等必要晶片。隨著庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及 AI 運算需求延伸至各類應用都帶動整體需求，預計 2025 年亞太 IC 設計整體市場將持續成長，年成長率達 15%。

(3) 台積電將持續稱霸 Foundry1.0 與 Foundry2.0 領域

在傳統 Foundry1.0 的定義下，台積電市佔從 2023 年的 59% 穩健攀升，預期 2024 年將達 64%，2025 年更將擴大至 66%，遠超三星、中芯國際、聯電等競爭對手。而在 Foundry2.0 定義中（包括晶圓代工、非記憶體 IDM 製造、封測、光罩製作），2023 年台積電市佔為 28%，但在 AI 驅動先進製程需求大幅提升的態勢下，預期市佔將在 2024、2025 年快速攀升，展現在新舊產業結構下的全方位競爭優勢。

(4) 先進製程需求強勁，晶圓代工廠擴產加速

先進製程（20nm 以下）在 AI 需求推動下加速擴產。台積電不僅在台灣廠區

持續打造 2nm 及 3nm，美國廠區 4/5nm 也即將量產。三星則憑藉著搶先進入 GAA 世代的經驗，在韓國華城（Hwaseong）打磨 2nm。而英特爾在新策略規劃下壓注 18A 製程開發，並以吸引更多外部客戶為未來幾年的目標。整體來看，預計晶圓製造 2025 年產能年增 7%，其中先進製程產能將年增 12%，平均產能利用率可望維持 90% 以上高檔，AI 需求驅動引爆的半導體榮景持續發酵。

(5) 成熟製程市況回溫，產能利用率將逾 75%

成熟與主流製程（22nm-500nm）應用範圍廣泛，涵蓋消費性電子、車用、工控等領域。展望 2025 年，預期在消費電子帶動，以及車用與工控領域可望出現零星庫存回補動能下，整體需求將持續回溫。8 吋晶圓廠平均產能利用率可望從 2024 年的 70% 攀升至 75%，12 吋成熟製程平均產能利用率也將提升至 76% 以上，預期 2025 年晶圓代工產能利用率平均提升 5 個百分點。

(6) 2nm 為 2025 晶圓製造技術關鍵年

2025 年將是 2nm 技術的關鍵年，三大晶圓製造商都將進入 2nm 量產。台積電戮力於新竹及高雄擴廠，預計在下半年穩健邁入量產。三星將依循往年一貫作風，預計較台積電早邁入生產。英特爾則在戰略調整下，全力聚焦導入晶背供電（BSPDN）的 18A。在 2nm 世代，三大廠商將面臨 PPAC（效能、功耗、體積、價格）的嚴峻挑戰，包括晶片效能、功耗表現以及單位面積成本的整體最佳化，尤其 2nm 製程將同步啟動 Smartphone AP、Mining Chip、AI Accelerator 等關鍵產品的量產，屆時各家的良率爬升速度與擴產節奏將成市場關注焦點。

(7) 封測產業生態重整，中國市佔將持續擴張，台灣 AI 封測優勢攀升

地緣政治影響之下，全球封測版圖正在重組。中國在「半導體自主化」政策推動下，晶圓代工成熟製程產能快速成長，下游 OSAT 產業也隨之擴張，正形成完整的製造產業鏈。台廠在此態勢下展現另一面產業優勢，不僅加速在台灣及東南亞布局產能，也深耕 AI 晶片先進封裝技術。展望 2025 年，中國封測市佔將持續上揚，台廠則鞏固在 AI GPU 等高階晶片的封裝優勢。預計 2025 年整體封測產業將成長 9%。

(8) 先進封裝：FOPLP 布局深耕，CoWoS 擴產倍增

半導體晶片功能與效能要求不斷提高，先進封裝技術日益重要。在 FOPLP 方面，2025 年起將快速成長，目前以玻璃 Base 製程為主，應用於 PMIC、RF 等小型晶片，預計技術累積數年後可望進軍封裝面積要求更大的 AI 晶片市場，並導入技術門檻要求更高的玻璃 Base 產品。另外，在 NVIDIA、AMD、AWS、Broadcom 與雲端服務供應商（CSP）等高效能運算客戶需求推動下，台積電 CoWoS 產能持續倍增，目標將從 2024 年的 33 萬片大幅擴充至 2025 年的 66 萬片，年增 100%，其中以 CoWoS-L 產品線年增 470% 為主要動能，而台灣設備供應鏈包括濕蝕刻、點膠、揀

晶等關鍵製程設備廠商，將在此波擴產潮中獲得更多成長契機。

IDC 指出，2025 年全球半導體產業將持續以雙位數成長，但仍需因應多重變數：包括地緣政治風險、全球經濟政策（包括產業補助、貿易關稅、貨幣利率等）、終端市場需求以及新增產能帶來的供需變化，都是 2025 年半導體產業值得關注的重要面向。

4. 競爭利基

(1)勝於國內同業之測試產品研發能力

自民國 90 年起，本公司就致力於半導體封裝測試相關機台及零件的開發，並持續與客戶合作參與產品研發。除已成功開發出半導體全自動切割清洗機，打入過去皆由國外大廠所壟斷之市場，並於植球機技術上領先國內同業，在測試治具及介面板的設計能力也能滿足客戶需求。本公司藉由每年持續投入研發經費及多年來與國內外半導體大廠的合作經驗，已在半導體封測設備領域擁有專業之技術及產品，並將有機會切入高利基型產品市場。

(2)良好之客戶與供應商關係

本公司與客戶或原廠皆保持長期且密切之合作關係，尤其因往來客戶皆為國內外知名廠商更屬不易。在肯定產品品質、研發能力及服務品質下，客戶在開發新製程所需產品時，會提出需求，使本公司掌握與客戶共同開發前瞻技術的機會；與供應商部份，本公司除與原廠具有十餘年之合作關係，也定期交流市場需求資訊，本公司亦與委外加工之供應商保持長期穩定並良好之關係。如此一來，除能確保順利銷售產品外亦能藉由良好之合作進一步掌握客戶未來需求及商機。

(3)客戶導向之服務策略

本公司除台灣市場之外，也陸續於其它潛力市場如大陸及新加坡佈點並取得銷售實績。除此之外，本公司亦配合大型客戶需求派駐技術人員提供綿密的技術支援服務。相較於部分國內規模較小之競爭對手，本公司之高度客戶導向服務策略除可配合客戶所需，提供彈性及高效率之售後服務外，亦能獲得更多客戶需求資訊，以利未來獲取更多商機。

(4)具競爭力之訂價策略

近年來本公司持續致力於自製設備之研發，已獲得成果。尤其在半導體切割清洗及植球機台部份，相較於目前國內半導體大廠習慣採用之國外設備，本公司在產品規格上已能跟上國外大廠但製造成本相對低廉，價格具競爭力以吸引客戶採用。在測試治具部份本公司採客製化並參與設計之商業模式，利於拉高產品附加價值。

(5)優異之機電整合技術

目前國內切入測試機具之廠商，均僅分別專精於機械或電子領域，然本公司近年來積極投入機電整合技術，能提供完整的解決方案給客戶，進一步強化

公司整體競爭力。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 台灣之半導體產業前景可期

在數十年的發展之下，台灣在全球半導體產業已佔有舉足輕重之地位，在 IC 製造與封測部分產值為全球第一，IC 設計產值則為全球第二。隨著全球消費性電子產品的推陳出新及功能日新月異，未來對 IC 之需求有增無減，而台灣之半導體供應鏈也將得以躬逢其盛。在半導體設備部份，即便目前台灣為全球半導體之生產重鎮，設備卻大幅依賴國外進口導致逆差高達 96.8 億美元，自製率尚未滿一成，主因過去國內和國外廠商之技術落差仍大。然而近年來國內半導體設備廠商的技術已逐漸有所突破，加上半導體大廠也有意藉此壓低成本，未來將有機會進一步成長。

除在一般 IC 封測相關設備產業外，快閃記憶體(Flash)的需求也將於未來持續成長，本公司近幾年積極投入記憶體及邏輯 IC 的測試介面產品，目前在記憶體測試介面產品已有不錯的營收，在邏輯測試部份亦有技術上之突破，可望增益其營運規模。

B. 測試介面及治具之客製化需求

本公司除了一般標準測試介面外，亦有客製化之測試介面及治具產品。由於客製化測試治具介面產品一般而言須在 3 週內交貨，這顯示本公司之技術能量及彈性交期之配合能力深受客戶信賴。

C. 優異之後勤支援能力

本公司目前代理之產品主要來自國外大廠，且銷售對象亦多為國內外知名企業，對後續技術服務水準皆要求甚嚴。而本公司之自製產品技術來自於公司本身，因此在產品設計及特性上也都能充分掌握。代理產品部份本公司由於與原廠合作關係已久，除與原廠之工程師合作默契極佳外，對產品之後續技術服務上亦相當了解。而近幾年來從主要客戶皆為長期配合之模式可看出本公司之後勤支援能力倍受客戶肯定。

D. 客戶群皆為國內外大廠

本公司之主要客戶皆為國內外半導體封測、記憶體及發光二極體大廠，客戶都已在自身專業領域經營長久，而在近年來科技產業大者恆大且併購風氣盛行之下，與大廠保持長久且穩固的合作關係及默契更形重要。而以本公司過去所累積的良好口碑基礎下，有機會隨著國內外大廠擴張的腳步再進一步獲取市佔率。

(2) 不利因素

A. 同業競爭激烈

由於半導體產業整體供應鏈已趨成熟，加上國內設備廠近幾年加強投入

研發逐漸趕上國外大廠或其競爭對手的技術優勢，故產品上無論在價格或品質上面臨國內外廠商的競爭。

因應措施：

- a. 持續投入研發經費發展更先進之製程產品，以增強客戶認同度並維持競爭優勢。
 - b. 高度客戶導向之服務。除台灣市場外，本公司已於大陸蘇州、新加坡及馬來西亞設有服務據點，未來亦將跟隨客戶擴廠腳步持續提供優質產品及服務，鞏固本公司於客戶供應鍊中之角色。
 - c. 拓展自製品之市場及服務。由於自製品於成本上較國外競爭對手佔有優勢，且公司在機構上及技術上的掌握度較高，再加上提供後勤支援上的較為便利，將能進一步強化競爭力並避免淪於單純價格競爭局面。
- B. 研發人才不易培養與取得

研發人才在半導體產業屬於相當重要的核心競爭力，擁有優於同業的技術不但是獲利的保證，也是公司能在市場上長久發展的基礎。但成熟的研發人員必須透過長期不斷的經驗累積來鍛鍊，而本公司之產品線亦較為特殊，因此擁有成熟技術之該領域研發人員較不易自市場上取得。

因應措施：

透過各項員工福利制度之推展，提供健全的內部訓練課程及穩定的工作環境，提升員工忠誠度以降低研發人才之流動率。

C. 半導體切割機台之轉換門檻較高

目前半導體切割機市場幾乎由日系大廠寡占，且由於半導體切割屬破壞性製程，較不易說服客戶轉換機台供應商。

因應措施：

- a. 初期藉由價格具競爭力之優勢及在地化即時服務等優勢說服台灣大廠先測試採用，待機台穩定性獲客戶認可後再進一步打入其供應鏈。
- b. 在機台應用面及功能面持續擴大創新，擴大潛力市場。藉由過去切割機之銷售實績及銷售其他商品時所累積之客戶滿意度，展現本公司專業技術能力，以強化客戶信心。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

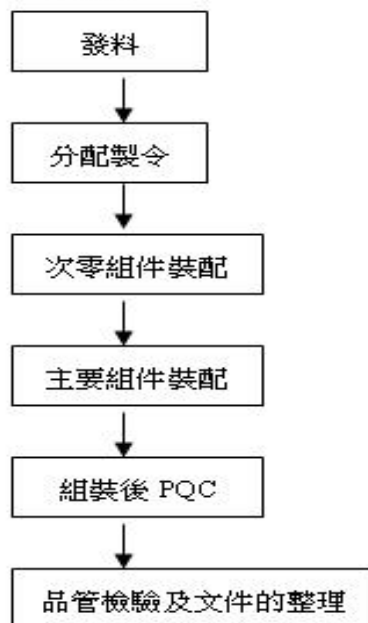
類別	產品名稱	重要用途
測試產品- 測試治具	Change Kit	將待測 IC 自動傳送至待測位置，並能在良好的定位及接觸傳導情況下完成後段測試。
測試產品-	Hifix	提供 Memory IC 與測試平台間的測試介面。

測試介面板	Load Board	提供 Logic IC 與測試平台間的測試介面。
	Probe Card PCB	提供空 PCB 板給針廠完成佈支針，完成前段 Wafer 之測試。
設備產品	晶圓切割機	晶圓切割機廣泛用於封裝製程。在前段的應用主要是將晶圓切割成一顆一顆的晶粒(chip)；而後段的應用則是將封裝好的基板分割成一顆一顆的元件(device)。
設備產品	植球機	植球機係將微小錫球(Solder Ball)精密置放於 IC 載板(Substrate)，而形成元件的外接腳。
設備產品	氣體偵測設備	主要用於監控工廠內可燃氣體、有毒氣體或氧氣等，適用於半導體、製藥及化工產業。
設備產品	量子電腦設備	主要用於量子電腦的超低溫冷卻與控制系統，是量子電腦的核心組件。

2. 產品之產製過程

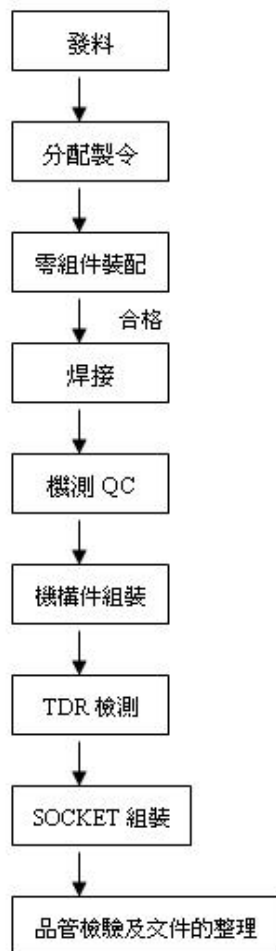
(1) 測試治具(Change Kit)

作業流程



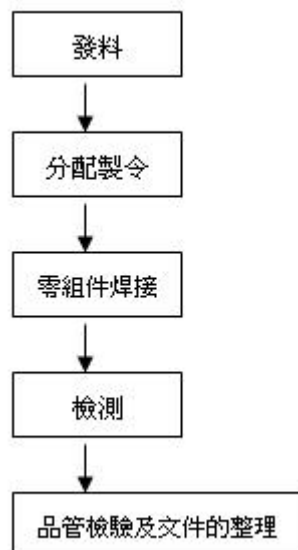
(2) 測試介面板(Hifix)

作業流程



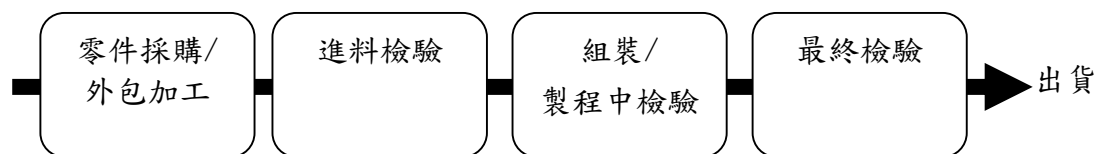
(3) 測試介面板(Lord Board 、 Probe Card PCB)

作業流程



(4) 晶圓切割機、植球機：

封裝設備的生產主要流程如下圖所示。在取得合格零件後，進行高精度的組裝。



組裝過程中需使用下列量測設備進行精度調校：雷射干涉儀、二次元、千分表、花崗岩平台…等等。

(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
加工件	乾供應商(註)	良好
PCB 板	丙供應商(註)	
探針	辛供應商(註)	
測試連接座	甲 1 供應商 (註)	

(註)因契約約定不得揭露供應商名稱，以代號為之。

(四)主要進銷貨客戶名單

1. 最近兩年度佔進貨總額 10%以上之廠商名單

單位：新台幣仟元

項目	111 年度				112 年度				113 年度截至前一季止			
	名稱	金額	佔全年 度進貨 淨額比 率	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔全年 度進貨 淨額比 率	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔當年 度截至 前一季 止進貨 淨額比 率	與發行 人之關 係
1	戊供應商	296,507	34.38%	—	戊供應商	310,911	35.54%	—	戊供應商	79,463	38.37%	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他	565,864	65.62%	—	其他	563,876	64.46%	—	其他	127,656	61.63%	—
	合計	862,371	100%	—	合計	874,787	100%	—	合計	207,119	100%	—

(註)因契約約定不得揭露客戶名稱，以代號為之。

主要進貨對象變動情形之分析及說明

(1) 本公司於 105 年 11 月 30 日取得科榮股份有限公司股權，至 113 年底佔其總發行股數 65.68%，該公司的主要供應商為戊供應商，主要是代理該供應商產品並向其購買後續維修零件。

2. 最近兩年度佔銷貨總額 10%之客戶名單

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔當年 度截至 前一季 止銷貨 淨額比 率	與發行 人之關 係
1	I 客戶	188,148	12.88%	—	AJ 客戶	180,827	13.12%	—	AJ 客戶	77,288	21.68%	—
2	其他	1,272,603	87.12%	—	其他	1,197,405	86.88%	—	I 客戶	53,201	14.92%	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	其他	226,018	63.40%	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1,460,751	100%	—	合計	1,378,232	100%	—	合計	356,507	100%	—

(註)因契約約定不得揭露客戶名稱，以代號為之。

主要銷貨對象變動情形之分析及說明：

(1) 112 年及 113 年 AJ 客戶及 I 客戶因廠務維護需求向我司購置廠務設備及維修服務。

三、從業員工資料

最近二年度及截至年報刊印日從業員工資料

單位：人；歲；年；%

年度		112 年度	113 年度	114 年截至 4 月底止
員工 人數	經理級以上	55	50	47
	一般員工	212	211	206
	合計	267	261	253
平均年歲		40.05	40.32	40.75
平均服務年資		8.90	9.49	9.67

學歷 分佈 比率	碩士	10.86%	9.96%	10.67%
	大學(專)	78.67%	78.16%	76.68%
	高中以下	10.47%	11.88%	12.65%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處份之總額，未來因應政策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：本公司最近年度及截至年報刊印日止並無環境污染情事。

五、勞資關係

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1)各項員工福利措施

本公司各項福利措施之擬定及推展，主要係為確保員工工作之安全與健康，藉由員工組成職工福利委員會之組織運作，使得同仁更樂於參與實際活動規劃與執行，促使各項活動更為出色、更為實際，以期達到調劑身心的目的。公司亦能體認員工係公司成長之重大動力，除上述組織運作辦理員工福利事宜外，另有相關福利措施如下：

- ①視生產及營運狀況發放績效獎金。
- ②辦理員工認股，共同參與經營，以期更凝聚向心力。
- ③辦理勞保及健保事宜，以穩定工作心情。
- ④辦理員工旅遊，藉以舒展心情，發揮工作效率。
- ⑤年終尾牙聚餐及摸彩，以犒賞員工年來之辛勞。
- ⑥員工訓練，讓員工早日進入工作狀況，發揮實力。
- ⑦三節禮金：員工結婚、生育、慶生補助。
- ⑧喪葬慰問金(包含父母、配偶、子女等)
- ⑨對於工作環境與員工人身安全的保護措施
 - A. 每年定期安排消防訓練課程，提供消防安全及危機應變處理方式之專業知識。
 - B. 辦公環境內設置符合法令規定之廣播系統及逃生設備，含滅火器、緩降梯、逃生指示、緊急逃生門等。
 - C. 辦公室內備有急救箱及防疫物資。
 - D. 每年定期安排員工年度健康檢查。

(2)進修、訓練制度與其實施情形

本公司由人力資源部的專門人員進行安排、規劃課程(包含公司委託其他單

位、機關協辦之訓練課程)等專業職能的教育訓練，配合公司營運方針及發展目標，提升所有員工之素質、充實基礎知識、並增進工作技能，以發揮員工潛在之能力，及配合法令之宣導。公司教育訓練體系分為內部訓練、派外訓練、出國研習等，以滿足員工自我實現的個人需求。

113 年員工進修與訓練情形：

113 年總共開設 74 班次課程，共培訓 121 人次，累積 1,506 人時數。整體而言人均受訓時數為 8 小時，相較 112 年，呈現成長的趨勢，顯現公司對於員工教育訓練的重視與投入。

項目	班次數	總人次	總時數
1. 新進人員訓練	10	19	893
2. 專業職能訓練	29	64	325
3. 通識課程	24	27	213
4. 管理領導課程	3	3	21
5. 其他	8	8	54
合計	74	121	1,506

(3) 退休制度與其實施情形

本公司遵循各地相關勞動法規、退休法規及制度，所有員工 100% 參與相關退休金計畫，按月提撥退休金並儲存於專戶內，以保障員工退休權益。於臺灣母公司與子公司依據「勞動基準法」或「勞工退休金條例」，針對員工所適用的新舊制度(以 2005 年 7 月 1 日為分界)按月提撥員工退休準備金。國外子公司亦按當地政府規定之制度，每月依當地員工薪資總額一定比率提撥退休金或養老保險金，並由當地政府管理統籌安排。

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
提撥方式	按員工每月薪資總額提撥 2%	依員工每月薪資之投保等級提撥 6%
提撥專戶	臺灣銀行員工退休準備金專戶	勞工保險局員工個人帳戶
提撥金額	撥存之餘額為新台幣 11,006 千元	提撥退休金為新台幣 5,152 千元

(4) 勞資間之協議情形

為維護各項員工權利，諸如僱用、工作時間、考勤、請假、獎懲、晉升等，除遵照政府有關法令規定外，公司依法辦理勞工保險及全民健保，並提撥職工福利金及退休準備金，同時並將相關員工之權益詳列入工作守則中，以保障員工權益。

(5) 與各項員工權益維護措施情形

本公司本著盈餘分享員工的理念，於章程上明訂員工分紅比率，以激勵員工

參與熱誠。並設置「意見提案箱」推行提案制度，凡任何有助於公司管理或制度或設施等改進方法或意見皆可提議，為鼓勵員工踴躍提案，依其影響程度發給不等之獎勵金，以提供員工工作及生活上之溝通與意見交流的橋樑。

(6)工作環境與員工人身安全保護措施：

建構安全環境，各出入口設有門禁管制及監視錄影系統；建築物、消防器具、電氣設備、飲用水、電梯等各項設備，定期進行檢查及維護，以保障員工人身安全。

由勞工安全專責單位及人員規劃執行及監督相關作業、教育訓練及內外部的溝通。並依照職業安全衛生法設置職業安全衛生委員會，每季定期召開會議，委員會成員由管理代表與勞工代表組成，主要統籌規劃職業安全衛生相關事務並推動職安衛管理系統的發展、職安衛教育訓練計畫及職業災害調查報告等，以落實員工之安全衛生管理，進而保障員工安全與健康。透過職安會達成公司內部各階層、外部相關單位及勞工代表溝通並確保同仁工作環境安全。

職安衛委員會下成立管理小組，負責定期執行風險評估程序與規劃及推動職業安全衛生政策，以及安排年度教育訓練計畫、職業健康服務及健康促進活動等，並於公司內部公告職業安全衛生管理辦法及宣導職安衛管理政策，並提供英文版本的公開程序文件予外籍員工閱覽，讓博磊科技全體同仁清楚瞭解公司職安衛政策。

另訂有安全衛生工作守則、緊急應變計畫、承攬商管理辦法等災害防止管理辦法，定期辦理檢查及預防災變所必要之安全衛生教育及演練，以提升同仁對於工作環境的危

害認知及緊急應變能力，並確保緊急應變計畫運作之執行的有效性。

對於工作場所中可能影響員工安全或健康之因素，公司亦定期安排清潔、消毒、作業環境測定與巡查，並且提供同仁每年享有免費的健康檢查、安排醫師到廠健康諮詢服務與辦理健康促進活動，讓員工擁有安全舒適的工作環境。

113 年實施情形：

類別	課程內容	受訓對象	受訓總時數/次數
一般訓練	一般職安教育訓練，包含法規概要、職安衛概念及工作守則、標準作業程序、緊急事故應變處理、消防及急救常識等。	新進員工	1 小時/2 次
危險狀況訓練	危險狀況緊急應變訓練，例如消防演練。	全體員工	4 小時/2 次
職業安全衛生相關人員證照訓練	職業安全衛生業務主管、一般安全衛生教育訓練、固定式起重機操作人員教育訓練等。	相關作業人員	201 小時/26 人次

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司及子公司妥善規劃人力資源，並適時因應

社會及經濟環境之變遷，檢討相關之人事制度，注重員工福利，提供優良工作環境並維持暢通之溝通管道及勞資關係之和諧，應無發生勞資糾紛之虞。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

1. 本公司設有資訊部，統籌資訊安全及保護相關政策制訂、執行及風險管理，由具有資安領域經驗的資訊同仁監督評估公司資訊與網路安全管理機制及方向。

2. 本公司在資通安全政策方面，已訂定『使用電腦化資訊處理作業』之內部控制制度，透過每年檢視和評估其作業程序，確保其適當性和有效性，因資安風險非屬公司重大營運風險，本公司的具體管理方案及投入資通安全管理之資源如下說明：

(1)系統安全監控

建立電腦網路系統的安全控管機制，以確保網路傳輸資料的安全，保護連網作業，防止未經授權的系統存取，造成機密資料之外洩。

(2)電腦病毒及惡意軟體之控制

公司郵件伺服器裝設防火牆及防毒軟體以隔絕外來侵害、防火牆及防毒軟體定期更新版本或病毒碼。

(3)軟體輸入控制

教育員工正確使用合法軟體之概念並定期檢查系統使用者是否使用非法軟體。

(4)網路服務及使用者之控制

公司依各業務範圍、權責分別設定使用者之帳號及權限，並且不得私自更換使用。員工離職或其他原因而成為非合法授權使用者時，資訊人員接獲通知後立即撤銷其帳號及權限。

(5)防火牆之安全管理控制

(6)網路線路備援與系統備援控制

(7)網路入侵之處理控制

資訊人員定期檢視伺服器上郵件收發情形，若有異常狀況應呈報權責主管處理

(8)資訊硬體之管理

電腦因人員離職或損壞繳回資訊單位時，資訊人員清除電腦硬碟資料，避免重要資料不當複製或外流。

(9)資訊安全會議與重要決議

開會日期	重要事項	決議結果
2024/02/20	1.個人電腦 Windows 11 升級案 2. 用戶端及博磊主機 E 防毒軟體續約	1. 115 台電腦升級至 Windows 11，汰換 23 台，以提升硬體防護力。 2. E 防護軟體目前排名仍超越微軟，並排名前 5 大，同意續約。
2024/11/05	主機 EDR 重新評估	為保護公司重要資料，同意改採用防護力第一的 C 公司。
2024/12/24	2025 年度資安計劃	1. 外部防火牆：2025 年為保護設備與資料安全，增加防護力，進行設備汰換。 2. 強化資料加密：2025 年增設主機防護與新增一道內部防火牆。 3. 強化備份：異地備份計畫新增雲端備份。
不定期	新進人員資安教育訓練	教育訓練場次及人數如下： 2024/04/30：6 人 2024/12/18：7 人

(二)列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約：

契約性質	契約相對人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
融資合約	台灣中小企業銀行竹北分行	105. 11. 30-115. 11. 30	長期擔保放款	不可變更資金用途
融資合約	台灣中小企業銀行	113. 05. 23-114. 05. 23	短期信用融資	無
融資合約	華南銀行	113. 12. 18-114. 12. 18	短期信用融資	無
融資合約	土地銀行	113. 11. 22-114. 11. 22	短期信用融資	無
融資合約	新光銀行	113. 03. 07-114. 03. 07	短期信用融資	無
融資合約	玉山銀行	113. 10. 30-114. 10. 30	短期信用融資	無
融資合約	第一銀行	113. 02. 02-114. 02. 02	短期信用融資	無
融資合約	台北富邦銀行	113. 09. 02-114. 09. 02	短期信用融資	無
融資合約	上海銀行	113. 02. 27-114. 02. 27	短期信用融資	無
融資合約	台新銀行	113. 11. 30-114. 11. 30	短期信用融資	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

1. 財務狀況-國際財務會計準則(合併)

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增減變動	
			金額	%
流動資產	1,581,944	1,662,544	80,600	5.09
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	46,971	94,571	47,600	101.34
應收帳款淨額	208,617	306,963	98,346	47.14
存貨	534,189	571,343	37,154	6.96
非流動資產	381,008	361,731	(19,277)	(5.06)
不動產、廠房及設備	138,311	134,445	(3,866)	(2.80)
資產總額	1,962,952	2,024,275	61,323	3.12
流動負債	919,404	959,262	39,858	4.34
合約負債	182,188	206,121	23,933	13.14
非流動負債	65,559	50,296	(15,263)	(23.28)
負債總額	984,963	1,009,558	24,595	2.50
股東權益總額	977,989	1,014,717	36,728	3.76
前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下：				
1. 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動：係因113年短期投資之金額增加。				
2. 應收帳款淨額：本公司113年底及112年底之應收款項淨額增加47%，113年度營業收入較112年度減少5%，主要差異來自於113下半年度新增加之應收款項，較112下半年度新增加之應收款項多97,824仟元所致。				
3. 非流動負債：係因113年長期借款之金額減少。				

資料來源：112 年度及 113 年度經會計師查核簽證之合併財務報告

2. 財務狀況-國際財務會計準則(母公司個別)

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增減變動	
			金額	%
流動資產	692,279	667,320	(24,959)	(3.61)
現金及約當現金	198,902	87,862	(111,040)	(55.83)
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	26,300	81,203	54,903	208.76
應收帳款-淨額	93,572	147,817	54,245	57.97
應收帳款-關係人淨額	90,860	33,085	(57,775)	(63.59)
其他應收款-關係人淨額	1,350	76,950	75,600	5,600
非流動資產	837,674	829,741	(7,933)	(0.95)
資產總額	1,529,953	1,497,070	(32,883)	(2.15)
流動負債	628,749	592,374	(36,375)	(5.79)
合約負債	30,760	17,812	(12,948)	(42.09)
非流動負債	59,328	44,967	(14,361)	(24.21)
負債總額	688,077	637,341	(50,736)	(7.37)
股東權益總額	841,876	859,729	17,853	2.12
前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下：				
1. 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動：113年因增加短期投資，故較112年增加。				
2. 應收帳款-淨額：113年銷貨予客戶測試類產品及廠務設備數量增加，因客戶收款天期較長，以致113年應收帳款淨額較112年增加。				
3. 應收帳款-關係人淨額：113年設備訂單透過子公司銷售者較112年減少。				
4. 其他應收款-關係人淨額：因子公司增加資金貸與，故金額增加。				
5. 合約負債：因113年設備類產品訂單金額降低。				
6. 非流動負債：係因113年長期借款之金額減少。				

資料來源：112 年度及 113 年度經會計師查核簽證之財務報告及合併財務報告

3. 影響重大者應說明未來因應計畫：上述變動對公司財務、業務並無重大之影響。

二、財務績效

1. 最近二年度經營結果比較分析-國際財務會計準則(合併)

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入淨額	1,460,751	1,378,232	(82,519)	(5.65)
營業成本	1,026,131	919,752	(106,379)	(10.37)
營業毛利	434,620	458,480	23,860	5.49
營業費用	364,964	400,943	35,979	9.86
營業淨利	69,656	57,537	(12,119)	(17.40)
營業外收入及利益	32,435	59,671	27,236	83.97
營業外費用及損失	11,138	10,823	(315)	(2.83)
繼續營業部門稅前淨利	90,953	106,385	15,432	16.97
所得稅費用	30,719	34,003	3,284	10.69
繼續營業部門稅後淨利	60,234	72,382	12,148	20.17
前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下：				
營業外收入及利益：113 年處分部分按公允價值衡量之金融資產，認列處分利益；再加上認列外幣兌換利益，以致 113 年營業外收入及利益較 112 年增加。				
繼續營業部門稅後淨利：113 年營業外收入及利益較 112 年增加，以致稅後淨利增加。				

資料來源：112 年度及 113 年度經會計師查核簽證之財務報告及合併財務報告

2. 最近二年度經營結果比較分析-國際財務會計準則(母公司個別)

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入淨額	403,960	399,175	(4,785)	(1.18)
營業成本	292,585	249,043	(43,542)	(14.88)
營業毛利	111,375	150,132	38,757	34.80
營業費用	164,304	184,324	20,020	12.18
營業淨利	(53,401)	(38,820)	14,581	27.30
營業外收入及利益	92,768	79,129	(13,639)	(14.70)
營業外費用及損失	10,074	9,344	(730)	(7.25)
繼續營業部門稅前淨利	29,293	30,965	1,672	5.71
所得稅費用	1,389	132	(1,257)	(90.50)
繼續營業部門稅後淨利	27,904	30,833	2,929	10.50

前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下：

營業毛利：因 113 年度產品銷售組合不同，故營業毛利較 112 年度變動。

營業淨利：因 113 年度營業毛利增加，且營業費用控制得宜，故營業淨利增加。

資料來源：112 年度及 113 年度經會計師查核簽證之財務報告及合併財務報告

3. 預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

銷售數量係依據市場需求狀況與發展趨勢，並參酌客戶未來一年預估訂單量而定。預計未來一年與前一年度相近，差異不大，且目前本公司財務健全，不致有重大不利影響。

三、現金流量分析：

1. 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年度自營業活動淨現金流量	全年現金流入(流出)量	現金剩餘金額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
745,156	12,111	(106,758)	638,398	-	-
113 年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：淨現金流入 12,111 仟元，主係因存貨減少及應收帳款實際收款轉為現金所致。					
(2)投資活動：淨現金流出 28,227 仟元，主要係因透過損益按公允價值衡量之金融資產所致。					
(3)籌資活動：淨現金流出 102,028 仟元，主係因非控制權益變動所致。					

2. 流動性不足之改善計畫：無流動性不足之情形。

3. 未來一年(114-個體)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年度自營業活動淨現金流量	全年現金流入(出)量	現金餘額(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
87,862	35,145	13,931	101,793	不適用	不適用
114 年度現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動：預期營運活動將有淨現金流入。					
2. 投資活動：預期投資大陸地區產生現金流出。					
3. 籌資活動：主係因增加短期借款，以致現金淨流入。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

1. 最近年度轉投資政策

本公司已於內部管理制度中訂定對子公司之監督與管理作業，以定期監督子公司營運狀況。

2. 轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

轉投資公司	主要營業項目	被投資公司最近年度損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
贊鴻實業股份有限公司	國際貿易業務	398	獲利主要係因業外收益(兌換利益)增加。	—	—
Zen Voce (Pg) Sdn. Bhd.	半導體相關設備及耗材的設計、研發及銷後服務	5,743	獲利主要係因當地客戶的機台維修及耗材需求增加。	—	—
Zen Voce Manufacturing Pte Ltd. (Singapore)	測試、一般設備及工程的製造與銷售	(7,517)	虧損主要係因當地客戶的機台維修及耗材需求減少。	—	—
Solution Integration Pte Ltd. (Singapore)	控股	(39,739)	為控股公司，因其下子公司博磊精密設備(蘇州)有限公司虧損，以致該公司也為虧損。	—	—
科榮股份有限公司	代理國內外廠商產品之報價投標經銷、安裝及維修業務	121,052	銷售半導體設備及維修服務。本業營運穩定獲利	—	—
博磊精密設備(蘇州)有限公司	半導體相關設備及耗材的設計、研發及銷後服務	(39,623)	銷售半導體設備及維修服務。本業營運虧損，持續進行客戶關係拓展、產品開發及降低成本。	—	—
碩磊科技(北京)有限公司	半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務	(1,295)	持續進行客戶關係拓展與產品開發，尚待發酵。	—	—

3. 未來一年投資計畫：擬於 114 年對孫公司博磊精密設備(蘇州)有限公司增資美金 200 萬元。

六、風險管理及評估：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項 目	111 年度	112 年度	113 年度
利息收入	2,640	9,793	12,318
利息支出	8,627	10,572	10,434
營業收入淨額	1,509,593	1,460,751	1,378,232
利息收入/營業收入淨額(%)	0.175%	0.67%	0.894%
利息支出/營業收入淨額(%)	0.571%	0.724%	0.757%

資料來源：111、112、113 年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

本公司及子公司前三年度利息支出佔營業收入淨額之比率分別為0.571%、0.724%及0.757%，對公司影響甚微。本公司將隨時注意利率走勢或定期評估銀行借款利率，並與往來銀行保持良好關係，爭取較優惠的利率，藉由採取適當因應措施，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司產品外銷報價以美元為主，自國外進貨亦以美元計價為主，應收付款項沖抵雖會產生一定之自然避險效果，惟在轉換成台幣時，仍會有匯兌損益產生，整體而言，匯率變動對本公司銷貨收入及獲利略有影響，本公司為降低匯兌風險，因應措施如下：

因應措施：

- 隨時蒐集匯率相關資訊，加強與銀行間之外匯相關避險策略諮商與規畫，以掌握匯率走勢。
- 客戶貨款及供應商購料款盡量採同一幣別，運用應收應付款項自然避險之方式，以規避匯率變動之影響。
- 在業務報價時，將匯率變動所可能產生之影響因素一併考慮，以規避匯率變動之風險。
- 持續利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動，達到規避匯率變動之影響。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

近期因原物料上漲影響，整體經濟環境呈現微幅通貨膨脹之趨勢，目前尚未因通貨膨脹因素而對損益產生重大影響之情事。且本公司隨時掌握全球政經變化及市場價格之脈動，並與供應商及客戶維持長期合作及良好互動關係，可適時調整採購與銷售策略，故本公司應能因應未來通貨膨脹等經濟局勢變化所帶來之影響，營運不致遭受重大之威脅。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 本公司及子公司基於保守穩健原則並未從事高風險及高槓桿投資之行為。

2. 本公司及子公司進行資金貸與他人之程序，依本公司及子公司所訂定之「資金貸與他人之管理辦法」辦理。

本公司於112年11月8日第九屆第十一次董事會因應孫公司博磊蘇州精密設備有限公司之資金周轉需求，對孫公司博磊蘇州精密設備有限公司資金貸與100萬美金，合約於113年11月7日終止。

本公司於113年11月7日第十屆第三次董事會因應孫公司博磊蘇州精密設備有限公司之業務往來需求，追認對孫公司博磊蘇州精密設備有限公司資金貸與150萬美金，生效日113年9月30日，合約於114年9月29日到期。

本公司於114年3月11日第十屆第五次董事會因應孫公司博磊蘇州精密設備有限公司之業務往來需求，追認對孫公司博磊蘇州精密設備有限公司資金貸與100萬美金，生效日113年12月30日，合約於114年12月29日到期。

3. 本公司及子公司為他人進行背書保證之程序，依本公司及子公司所訂定之「背書保證管理辦法」辦理。本集團政策規定僅能提供財務保證予完全擁有之子公司。本公司於112年3月8日第九屆第八次董事會通過本公司為子公司贊鴻實業股份有限公司背書保證，係因該子公司向上海商業銀行北新竹分行申請短期借款額度新台幣一仟萬元以為營運週轉金，因本公司為其持股100%母公司，因應銀行要求本公司為其背書保證。

本公司於113年5月9日第九屆第十三次董事會通過解除本公司為子公司贊鴻實業股份有限公司背書保證，係因借款合同已到期不再續約。

4. 本公司及子公司進行衍生性商品交易，依本公司及子公司所訂定之「博磊科技遠期外匯交易處理程序」辦理。本公司於101年因避險性需求，曾辦理遠期外匯交易，已按照處理程序之規定辦理公告、申報及入帳。本公司及子公司最近年度及截至本次年報刊印日止，並無從事衍生性商品交易之情事。

(三) 未來年度研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司一直是以自有技術來建立品牌與公司形象，對研發的投入亦是不遺餘力。本公司將持續在114年投入研發經費，主要用於新製程與新產品開發及量產。基於過去幾年市場開發的經驗，本公司已經與客戶有良好的互動關係，產品開發均能切中客戶的應用與需求。此外每年度仍將投入約當營收4.0%~6.0%之經費厚植公司的研發工程實力。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法規變動情形，並適時提供管理階層作為策略因應之參考，以充分掌握並因應市場環境變化。最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司及子公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司為推動資通安全相關政策，落實資通安全事件通報及相關應變處理，定期評估資通安全風險，嚴格落實資通安全風險管理。

本公司及子公司隨時注意產業相關技術發展變化，掌握市場趨勢，評估其對公司營運所帶來之影響，並投入相當之發展經費與人力以從事研究發展、提升產品效能及降低營運成本等措施因應。最近年度及截至本次年報刊印日止，本公司及子公司並無受到科技改變及產業變化而有影響財務業務之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司企業形象良好，截至本次年報刊印日止，無任何情事導致企業形象改變，造成企業危機之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司及子公司目前無併購之計畫。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司及子公司目前無擴充廠房之計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 進貨集中之風險

本公司於 112 及 113 年度並無對單一供應商進貨比重逾 30%以上之情事，亦無對單一集團有進貨比重超過 50%，無進貨集中之情形。

(2) 銷貨集中之風險

本公司於 112 及 113 年度並無對單一客戶銷售比重逾 30%以上之情事，亦無對單一集團有銷售比重超過 50%，無銷貨集中之情形。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至本次年報刊印日止，本公司董事或持股超過 10% 大股東並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司最近年度及本年度截至本次年報刊印日止，經營權並無改變。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及年報刊印日止之處理情形：

(1) 公司 113 年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(2) 公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無此情形。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

最近年度依證期局所訂「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」所編製之

- (一) 關係企業合併營業報告書：請詳公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)
- (二) 關係企業合併財務報表：應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。
- (三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

博磊科技股份有限公司



李篤誠

